

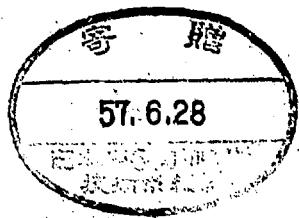
水素リサイクリングに関連した
素過程データ検討作業会報告

市 川 行 和

(1982年2月19日受理)

IPPJ-DT-93

1982年3月



名古屋大学プラズマ研究所

Proceedings of the Workshop on Elementary Process in Hydrogen Recycling

Yukikazu Itikawa

**Research Information Center,
Institute of plasma Physics,
Nagoya University, Nagoya 464**

Abstract

On September 7 and 8, 1981, a workshop was held at the Institute of Plasma Physics to review the state of the art of the study of elementary processes in hydrogen recycling in fusion reactors. The processes considered are reflection, adsorption, desorption, trapping, particle-induced emission, chemical sputtering, and diffusion in metals. The present report is the proceedings of the workshop and contains rather comprehensive reviews each on the processes considered. The workshop was held as part of the joint research program of data compilation at the Research Information Center, Institute of Plasma Physics.

Further communication about this report is to be sent to the Research Information Center, Institute of Plasma Physics, Nagoya University, Nagoya 464, Japan.

はじめに

プラズマ研究所核融合研究企画情報センターでは、プラズマ-壁相互作用に関するデータの収集、評価の活動を行っている。その活動の一環として、1981年9月7・8日、「水素リサイクリング」における素過程について、研究の現状を概観し、データ収集の可能性を検討するための会合を開いた。本報告書は、その会合において報告、討議された内容を、広く関心のある研究者に知って頂くために作成されたものである。「水素リサイクリング」の現象は、非常に多くの素過程が、繁雑にからみあっており、その解明には、異なる種々の分野の知識が必要になる。企画情報センターでは、この種の検討会を今後も開くと共に、可能な限り、関連する素過程についてデータの収集等を行っていくことを計画している。関連する研究を行っている研究者の協力をお願いしたい。

なお、関連する話題についての研究会が、プラズマ研究所において最近いくつか開かれており、それぞれ報告書が出版されている^{*}。本報告書を作成するにあたっては、それらとの重複をなるべく避けるように配慮した。従って、それらの報告書も合わせて利用して頂きたい。

プラズマ研究所核融合研究企画情報センター

市川行祐

* 「固体中の水素同位体の拳動-ブリスタリングとの関連」

核融合研究別冊 46 No.12 (1981)

「周辺プラズマにおける素過程」

核融合研究別冊 46 No.13 (1981)

目 次

1. 水素リサイクリングに関する基礎論
市川 行和
2. 水素同位体の固体表面における反射
森田 健治
3. 金属表面上での水素のふるまい
村田 好正
4. ディソープション過程と水素リサイクリング
小間 篤
5. 化学スパッタリング
(固体表面との水素粒子の化学反応)
西堂 雅博
山田 稔司
6. トランピングおよびリエミッション
田辺 哲朗
7. 核融合燃料の水素透過と表面効果
難波 隆司
山脇 道夫
菅野 昌義
8. 水素の拡散
紀 隆雄

水素リサイクリングに関する素過程

プラスマ研究会連絡会議セミナー

市川 行和

水素(以下全て同位体を含む)のリサイクリングの問題は、プラズマ-壁相互作用における重要なテーマの一つである。そのメカニズムはかなり複雑であるが、大ざっぱに分けて次のような素過程からなると考えられる。

まず、水素(中性およびイオン)が壁に当ると、その一部は反射されて plasma の方へ戻る。ただし、その際に中性水素原子として戻るもののはかに、一部は H^+ および H^- となって反射されるものがあろう。次に反射されないものは、全て壁の表面にくっつく(吸着)か、内部に埋め込まれる(trapping)。表面にくついた水素は、そのままでもはがれる(脱着)し、また plasma 側からやってくる粒子(光子、電子、イオン)によって脱離する。また、表面層内に埋めこまれた H は層内を拡散し、一部は bulk の方へ行ってしまうが、一部は表面へ出てきて、上記の機構で脱着する。また、イオンや電子(?)が高いエネルギーで飛びこんでくると、それによって強制的に外へ放出される(particle-induced re-emission)。さらに、水素が壁から放出される機構として、他の粒子との化学反応の結果、起るものもある。(chemical sputteringなど)

これらの素過程について、どのような物理量を、何をパラメタとして知りたいかと、下記にまとめて示し、最後に共通の問題点をあげておく。

(1) 反射

物理量: 反射係数

反射された粒子の
角分布
エネルギー分布
成分(正、負イオン、中性粒子の割合)

パラメタ: 入射エネルギー

入射角

H^+ と H^- の違いがあるか

(2) 吸着

物理量： 吸着係数

パラメタ： 入射エネルギー

表面温度

(3) 脱着 (thermal re-emission)

物理量： re-emission rate

recombination rate (分子で放出される場合)

エネルギー分布

成分(原子、分子、イオンの割合)

パラメタ： 表面温度

(4) Trapping

物理量： trapping coefficient (efficiency)

深さ分布

パラメタ： 入射エネルギー

入射角

表面温度

(5) particle-induced re-emission (desorption)

物理量： re-emission rate (desorption cross section)

放出された粒子の
| エネルギー分布
| 角分布
| 成分

パラメタ： 入射エネルギー

入射角

表面温度

入射粒子の種類による違い

(6) 捕獲

物理量： 捕獲係数

(trapping / detrapping frequency)

パラメタ： 温度

radiation damage 指度.

共通の問題点

- (a) 関与する粒子がトリチウム(T)の場合には特別なことが起るか
- (b) surface conditionによる違
 - surface structure (roughness)
 - adsorbed particles の有無による差異
(C, O,)
- (c) 化学反応が影響することがあるか
 - 表面での reaction → chemical sputtering
 - reactive trapping

参考文献 (注なもの)

- (1) G.M. McCracken and P.E. Stott: Nucl. Fusion 19 889 (1979)
"Plasma-surface interactions in tokamaks"
- (2) K.J. Dietz et al: in "Atomic and Molecular Processes in Controlled Thermonuclear Fusion" (ed. McDowell & Ferendeci, Plenum, 1980). Chapt.5
"Wall Processes and impurity production due to hydrogen species"
- (3) H.C. Howe : J. Nucl. Mat. 93/94 17 (1980)
"Hydrogen recycle modeling and measurements in tokamaks"

水素同位体の固体表面による反射

名古屋大学 工学部 森田 健治

1. はじめに

水素同位体イオンの固体表面による反射（電子反射率、エネルギー反射率など）について、これまで得られてきたデータの概要を紹介する。このデータは核融合炉炉器設計における、プラスマ中の水素の散逸活性粒子（H, D, T）が第I壁面に与り反射され、エネルギーを得てプラスマ内に再流入する（T1/T4, T7の問題と結びつけてある）。具体的には炉設計において粒子平衡およびエネルギー平衡を達成するためには、粒子の反射率計算から粒子の反射率係数のデータが必要である。従って反射率係数を理論的に算出することはも重要な問題である。ここで取り扱う粒子が水素反射率係数は約10⁻⁴から数十EVである。

2. 反射率

核融合炉設計における重要な水素同位体の反射率に関する量は、粒子反射率係数 R_N 、およびエネルギー反射率係数 R_E の2つである。これらの量は通常、ある反射方向における反射粒子のエネルギー（一人当たり）（一重微分反射率係数）を積分して得られる。粒子が固体表面に対してエネルギー E_0 、入射角 ϕ_{in} で衝突し、反射角 ϕ_{ref} で散乱角 θ 、粒子の入射方向に垂直なかつ固体表面に平行な方向から測定方位角 ψ で反射された粒子のエネルギー、スベクトル $n(E_0, \phi_{in}, E, \theta, \psi)$ を用いて、粒子反射率係数 R_N は

$$R_N(E_0, \phi_{in}) = \int_0^{E_0} dE \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} n(E_0, \phi_{in}, E, \theta, \psi) 2 \sin \theta d\theta d\psi \quad (1)$$

で定義される。式(1)のそれは、入射粒子速度について離散化した微分反射率係数である。又エネルギー反射率係数は

$$R_E(E_0, \phi_{in}) = 1/E_0 \int_0^{E_0} dE \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} E n(E_0, \phi_{in}, E, \theta, \psi) 2 \sin \theta d\theta d\psi \quad (2)$$

で表わされる。これらの反射率係数は、実験的または理論的に最も多く調べられていて、下記の複数式（式-1～式-5）の函数として表されている。

$$\epsilon = \frac{E_0 a}{e^2} \frac{N_2}{Z_1 Z_2 (M_1 + N_2)} \quad (3)$$

ここで a は電子の電荷、 d はトーラス・アーマの距離距離、 M_1, Z_1, Z_2, M_2 はそれぞれ入射粒子と反応粒子の質量と電荷である。

3. 測定手段

電子反射係数およびエネルギー反射係数は、複数の反射方向 (B, G) 上で、エネルギートトル (微分反射係数) n を測定した、式 (1), (2) の下式から得られる。この方法では反射係数と電荷除じて電子密度情報を得られる。反面、この取り扱う粒子のエネルギー範囲では、反射係数が大部分は中性粒子であるため、中性粒子のエネルギー分析を行わなければならぬ。この下の実験装置は太がかりであり、さらに反応の反射方向 (B, G) について、エネルギー・スペクトルを測る外は時間も要する。

他方、このエネルギー-角域の電子反射係数は、反射率測定から放出された電子の大半が反応電子で、スペクトルされる複数電子や不純物電子・電子は小さい。この事実から下記のとおり、種々電子反射係数やエネルギー反射係数を直接測定する方法が開発されてゐる。

- Calorimeter 法⁽⁴⁾⁻⁽⁷⁾ → エネルギー反射係数
- Proportional counter 法^{(8),(9)} → 電子反射係数、エネルギー反射係数
- Trapping yield の決定を利用した方法⁽¹⁰⁾ → 電子反射係数

4. 実験データ

電子率 1 万分の反射は 1963 年から実験的に調べられてきた。ノックロ率度から実験結果の大部は、反射角 θ におけるエネルギー・スペクトルに関するものである。中性粒子のエネルギー範囲を行へ、全反射係数の実験データを得られたのは、この問題の種類が研究対象電子の質量が比較的軽いからである^{(11),(12),(13)}。又二種までの測定で実験データの反射角は種々測定法によつて異なる。電子データにまとめよう。

4-1 電子反射係数

複数の種類の H^+ , D^+ , T^+ , He^+ を衝突した場合の電子反射係数 R_N の θ の相違はエネルギー E の函数といふ事が下線を引かれてある⁽¹⁴⁾。图 1 から R_N の絶対値は E の增加と共に漸減の減少傾向がある。又、種々の種類の Z ($Z = R_N$ の絶対値は factor Z の範囲の値が、 $Z = 1$ の場合 $E \approx 0.1$ 以下。領域では $Z = 1$ ほどでないことがわかる。 $(Z = 1$ の場合 $E = 0.744$, $8 keV H^+ \rightarrow Fe$ の場合 $Z = 1.95$, $8 keV H^+ \rightarrow C$ の場合 $Z = 19.3$ である)。

图 2 の電子反射係数 R_N を入射粒子の物理量と反射係数を計算した反射係数 R_N^* と scaling は、图 2 から R_N^* は反射係数 R_N は一つの曲線に統合された⁽¹⁵⁾。

4-2 エネルギー反射係数

エネルギー反射係数のデータを图 2 に示して⁽¹⁶⁾。图 2 では反射粒子の質量とエネルギーを計算したエネルギー反射係数 R_E の E の函数として E^{α} と表してある。この関係は R_E^* の値と R_N^* の関係における曲線を scaling したものである。

4-3 反射電子の荷電状態

水素同位体・反射粒子は正イオン (H^+)、中性粒子 (H) および電子 (H^-) の割合を取る。Pike: $H^+ + Au \rightarrow Au + \gamma$ で得た測定値によると実験結果の一例を図3に示す¹¹⁾。この図では $E = 8 keV$ 以下のところまで γ は反射粒子の割合が正イオンの割合よりも多くなる。正イオン割合はこのエネルギー範囲で 10% 程度で、エネルギーの增加とともに直線的に増加してくる。又、電子の割合はエネルギーとともに減少し、最大値を経てその後減少する。しかし、これらの値は絶対値ではなく表面汚染により影響を受けることべ報告されている。

5. 反射係数の理論的取り扱い

高エネルギーにおける表面に対する反射・透視入射イオン・偏光・種的原子との二種的衝突の過程を取り扱うために、粗元素イオンの反射係数は、その透視と反射的計算による方法と統計的方法による直接確率計算による方法が用いられてきた。その方法は下記のようになされている。

- 1) 純統計論による方法^{12), 13)}
- 2) 単一衝突模型による方法^{14), 15)}
- 3) 計算機シミュレーションによる方法¹⁶⁾

これらの中でも理論的取り扱いによる計算した反射係数の結果は、これまでとの適用可能なエネルギー範囲において、反射係数の実験結果よく説明している。単一衝突模型に基づく取り扱いは、粒子反射係数 $R_N(E)$ は Z_A の大きさと種的計算 ($1/A(Z_A) R_N(E)$) は $R_N(E)$ と一致しない。ここで $R_N(E)$ は種的依存しない、 Z_A に対して單純減少の関数である。 $A(2n)$ 物質による断面積と $A(2n)E^2$ で割られた時の係数である。この結果は図2の実験データ。物質に対するパラメータは物質面上断面積の相異により至りで、これを考慮して $R_N(E)$ を求めている。図2の実験データを陽子断面積の算出 “ $R_N(E)$ ” に近づけて、曲線の scaling がきこにはこの結果に基づいてある。

他方、単一衝突模型による反射粒子（エネルギー・スペクトル（= 粒子の反射係数）の計算結果は、必ずしも実験結果と一致しない。多組成材料を含む複合材料に対する扱いは、入射側における反射係数を理論的に求めるために、まず複合反射係数よく説明し、かつ取り扱いやすい理論的手段を開拓することから始めてある。

6. 合金、化合物に対する反射係数

物質面上断面積の相異を用いて計算した反射係数 $A(2n)R_N$, $A(2n)R_E$ および $R_N(E)$, $R_E(E)$ が scaling によって算出され、二元合金や二層子化合物（原子番号 a , b , 厚さ a, b, d ）に対する反射係数は、単一衝突模型に基づく式で表わされる。

$$R_g(E_0, az_a + bz_b) = (a\epsilon_g(E_0, \epsilon_{1n}) + b\epsilon_g(E_0, \epsilon_{1n})) / (aA(z_a) + bA(z_b))$$

$$R_E(E_0, az_a + bz_b) = (a\epsilon_E(E_0, \epsilon_{1n}) + b\epsilon_E(E_0, \epsilon_{1n})) / (aA(z_a) + bA(z_b))$$

$= z^{-2} E_0^2$, E_0^2 は種的原子 a, b の断面積を種的エネルギーである。これらの式において物質面上断面積は、アーノルト法則¹⁷⁾、即ち各原子の平均値が用いられて決定した。

7. まとめ

これまで得られたこの種元素イオンの反射データの現状を総合した。图1～5がその様子を示す。

実験データがいくつもあるが、斜入射の実験データもその2つ、二つともデータの大きさとモニタカルロシミュレーションを用いて補うことで試せられる。

二つの実験データの大半は入射粒子エネルギーと角度との関係である。実験結果は、等離子中の中性粒子である。1keV以上の入射粒子の周囲内に走査範囲は荷電率の平均自由行程半径へ直角長さ λ_{\perp} 、1度入射したときの中性粒子入射の平均半径 λ_{\parallel} と形狀の関係を述べる。 λ_{\perp} は λ_{\parallel} より大きい。

電荷水準に対する反射係数のデータは、要素の微分反射係数測定法を用いて得られる。17～22、系統的な実験データがある。又、回折角における荷電率。回折は物理的空間の条件で観察であり、強度による回折は解明されていないと考えられる。

文献

- 1) R. Behrisch, "Fusion-first wall problem," in :Critical Materials Problems in Energy Production (ed. C. Stein), Academic Press, New York (1976).
- 2) C. N. McCracken, in :Plasma Wall Interaction, Pergamon Press, New York (1977), p. 339.
- 3) 総説 Review, E. S. Mashkova, Radiat. Eff. 54, 1 (1981).
- 4) E. S. Mashkova and V. A. Molchanov, Radiat. Eff. 16, 143 (1972).
- 5) H. H. Andersen, Radiat. Eff. 2, 51 (1970).
- 6) H. H. Andersen, Radiat. Eff. 2, 179 (1971).
- 7) H. H. Andersen, T. Lenskaer, G. Sidenius and H. Sorensen, J. Appl. Phys. 42, 13 (1971).
- 8) G. Sidenius, Phys. Lett. A49, 469 (1974).
- 9) G. Sidenius and T. Lenskaer, Nucl. Instr. Meth. 172, 673 (1976).
- 10) J. Bohdansky, J. Roth, M. K. Sisha and W. Ottenberger, J. Nucl. Mater. 63, 115 (1976).
- 11) H. Sorensen, Appl. Phys. 2, 321 (1976).
- 12) J. Scheu, H. Sorensen and U. Littmark, J. Nucl. Mater. 76 and 77, 359 (1978).
- 13) B. Hildebrandt and R. Manns, Phys. Status Solidi A38, K115 (1976).
- 14) H. Verbeek, J. Appl. Phys. 46, 2981 (1975).
- 15) R. S. Bhattacharya, W. Eckstein and H. Verbeek, J. Nucl. Mater. 72, 420 (1979).
- 16) W. Eckstein and H. Verbeek, "Data on Light Ion Reflection" IPP 9/32 August 1979, Max-Planck-Institut für Plasmas-Physik, Garching bei München.
- 17) T. Tabata, R. Ito, I. Morita and Y. Itikawa, Jpn. J. Appl. Phys. 20, 1929 (1981).
- 18) R. Weissmann and P. Sigmund, Radiat. Eff. 19, 7 (1973).
- 19) J. Bottiger and K. B. Winterbon, Radiat. Eff. 20, 65 (1973).
- 20) K. B. Winterbon, P. Sigmund and J. B. Sanders, Mat. Fys. Medd. Dan. Selsk. 37, No.14 (1970).
- 21) J. Vukanic and P. Sigmund, Appl. Phys. 11, 265 (1976).
- 22) G. N. McCracken, Rep. Prog. Phys. 38, 241 (1975). G. N. McCracken and M. J. Freeman, J. Phys. B2, 661 (1969).
- 23) T. Ishitani, R. Shimizu and K. Murata, Jpn. J. Appl. Phys. 11, 125 (1972).
- 24) M. T. Robinson, J. N. Torrens, Phys. Rev. B29, 5008 (1974).
- 25) O. S. Oen and M. T. Robinson, Nucl. Instr. Meth. 172, 647 (1976).

- 26) J. E. Robinson, K. K. Kwok and D. A. Thompson, Nucl. Instr. Meth. 132, 667 (1976).
 27) P. J. Schneider, W. Eckstein and H. Verbeek, "9th Intern. Conf. on Atomic Collisions in solids" (Lyon, 1981).

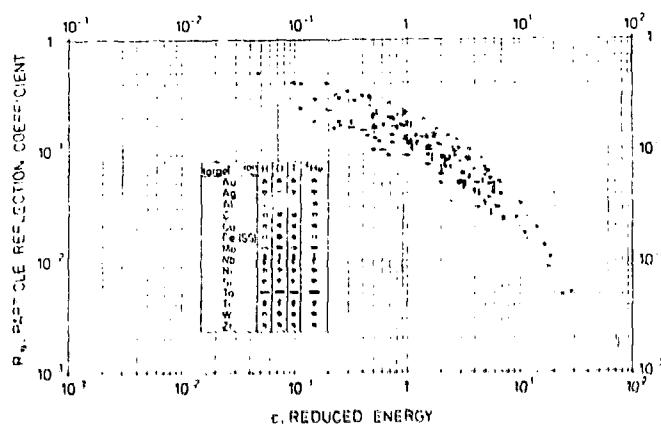


図1 繰返の固体表面における H^+ , D^+ および H_2^+ の粒子反射係数
 (W.Eckstein et al., Ref. 16)

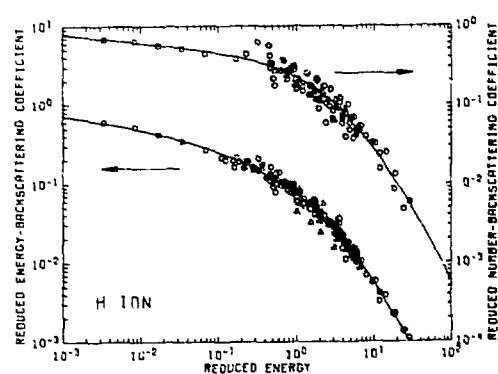


図2 H^+ に対する繰返粒子反射係数とその倒算
 パーティクル・反射係数との比較
 (T.Tahata et al., Ref. 17)

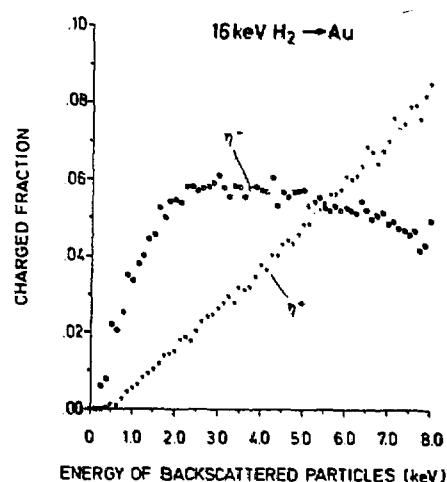


図3 16 keV H_2 による Au 上の入射エネルギーに対する
 反射荷電粒子の割合 (W.Eckstein et al., Ref. 16)

金属表面上の水素の吸着

東京大学物性研究所 森田好正

水素吸着基礎的な元素について述べる下、第一回では電子分光法により、検出原理と不純物との関係、低速電子線炉（LEED）による能動的測定、検出時間の問題などについて、併せて実験結果より多く述べる。また、この研究会の主題である「表面」からして内容が多少取上げられる。

1. 附着

1. 1. 附着確率（sticking probability）

W(100) 上の水素吸着¹⁾、同上に述べたとおり、清浄表面の活性化吸着²⁾、直線的附着確率が減少する。³⁾ 1.2. 清浄表面の附着確率 S_0 （initial sticking probability）は

$$S_0 = 0.51 \pm 0.03$$

である。 S_0 の $T = 0$ 附近的⁴⁾

$$S_0(D_0/W(100)) \approx 0.57 \pm 0.03$$

より、

$$\frac{S_0(D_0)}{S_0(H_2)} = 1.12 \pm 0.12$$

となり、ある一定の吸着量⁵⁾までは⁶⁾ 3 倍以上。⁷⁾

1. 2. surface condition の変遷

向日田（100）面表面の清浄表面⁸⁾、LEED パターン（5×20）と「非晶質」表面の大きさの単位格子を有する表面⁹⁾、（1×1）のパターンと同じ次元の周期構造の表面¹⁰⁾。前者は空気中で後者に加熱すると逆の¹¹⁾ 125°C で（5×20）パターンは完全に表面を占める。

（5×20）表面は水素吸着による吸着¹²⁾ が生じ、（1×1）表面は水素による吸着¹³⁾、少くとも（5×20）表面はすべて 10^2 以上の附着確率¹⁴⁾ である。

1. 3. 溫度と吸着量

昇温脱離スペクトル（thermal desorption spectrum）は W(110), (111), (100) 上の水素吸着¹⁵⁾、図 2 によると、大半は吸着¹⁶⁾、すなわち温度上昇とともに吸着表面に吸着する大半¹⁷⁾ 吸着¹⁸⁾ である。3. また 100 K 以下では H_2 分子が次第に非解離¹⁹⁾ され、脱離吸着²⁰⁾ される。すなわち H_2 分子が表面に吸着する²¹⁾ が、脱離吸着²²⁾ される²³⁾ ことである。

図 2 のスペクトルの基部²⁴⁾ が上り坂²⁵⁾、脱離エネルギー（desorption energy）が吸着²⁶⁾、アイソトローピック²⁷⁾ である²⁸⁾ ことは²⁹⁾ 説明³⁰⁾ できる。



図 1
W(100) 上の
水素吸着の初期
附着確率

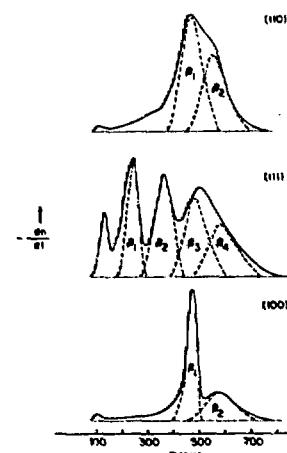


図 2
W(110),
(111),
(100) 上
の水素吸
着・脱離
スペクト
ル

1.4. ティント-ガス効果とESD。

電子衝撃脱離 (electron-stimulated desorption, ESD) は W(100) 上の水素脱離による $\sim 10^{-2}$ A, 100 eV の電子衝撃により H^+ と H_2 脱離して 3×10^{-3} 安定電流放出する。図 3 に示すように、イオニ電流と脱離率の関係が示すように、 H^+ と D^+ の脱離率は $\sim 10^3$ 倍である。

極大点で ~ 3 最大 ESD イオニ電流 $Q^+(H^+)$ は概算

$$3.4 \times 10^{14} \text{ 原子/cm}^2 \cdot \text{sec}$$

$Q^+(H^+) \approx 1.8 \times 10^{23} \text{ cm}^2/\text{electron}$
とすると、 $Q^+ \sim H^+ \sim D^+$ の比は

$$\frac{Q^+(H^+)}{Q^+(D^+)} \approx 100$$

非常に大きい“isotope effect”を示す。¹⁾

1.5. 化学反応の特徴とその原因?

Pt(111) 面では少しだけ 2 次元的 (平面面), 中央は stepped surface, (111) 面の 7×2×2 と呼ばれる 2 次元的 (表面), また D_2 分子は表面で H_2 の分子数と同程度, HD の散乱 (表面) と D_2 と H_2 , Pt(111) と flat surface の間で反応が進む。²⁾

W(100) 上の水素脱離の場合は、100 K 以上の温度領域での化学反応が次第に現れ、水素は解離して原子状、 $<100>$ 方向に、W 2 原子と結合して bridge site に結合 (2×2 型), CO と共存する場合では H_2 は解離しない, H_2 は結合しない。³⁾

2. 表面拡散

2.1. 拡散係数

W(110) 上の水素脱離、電界放電顕微鏡 (field emission microscope, FEM) による current fluctuation により、水素の表面での拡散係数 D が求められる。概算値が 60% の D の活性化エネルギー ($1/T$) を図 4 に示す。

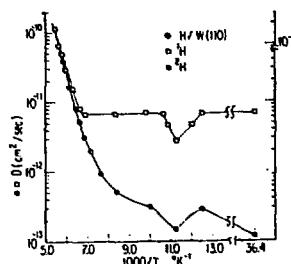


図 4

$W(110) + {}^2\text{H}, {}^3\text{H}$
の表面拡散係数
数の温度 ($1/T$) 依存
性

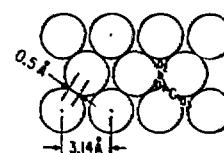


図 3

$W(100)$ 面
の原子配列

${}^3\text{H}$ の場合、 $200 \geq T \geq 143 \text{ K}$ の温度範囲では activated diffusion と活性化エネルギー E_{diff}

$$E_{\text{diff}} = 4.80 \pm 0.3 \text{ kcal/mole } (0.21 \text{ eV})$$

とある。140 $\leq T \leq 281 \text{ K}$ の範囲、 $D \approx 2 \text{ Å}^2/\text{sec}$ 、 ${}^3\text{H}$ と tunneling と表面拡散、tunneling と barrier hopping の 0.47 eV とある。また $W(110)$ 面の 1×1 型 $\rightarrow a_1 \rightarrow C \rightarrow a_2 \rightarrow a_1$ の軌道が存在する。 $a_1 \rightarrow b \rightarrow a_2$ は自由拡散とよばれ、 2×2 の表面では $a_1 \rightarrow a_2$ の軌道が存在する。

2.2. ピリオード効果⁶⁾

図4をもとにすると、重水素、 ^{2}H の核の活性化エネルギーは ^{1}H よりも約10倍大きい。

$$E_{\text{diff}}(^2\text{H}) = 4.85 \pm 0.15 \text{ kcal/mole}$$

また、(a), tunneling⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾

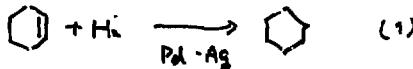
$$D(^2\text{H}) \sim (1/57) D(^1\text{H})$$

等により大きなisotope effect⁹⁾。

3. 表面反応とIsotope効果¹⁰⁾

図6が示すように、Pd-Ag合金上にAuを蒸着すると、 H_2 の拡散作用と H_2 の吸着による現象が観測される。

cyclohexeneはPd-Ag合金を触媒とする。



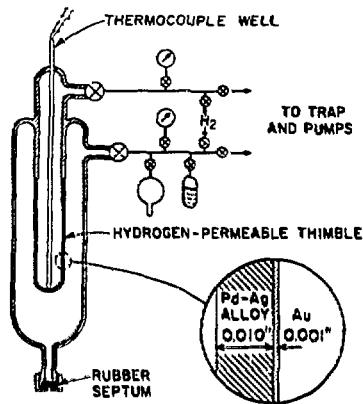
ただし、cyclohexaneは遷元反応。Auは：a) 水素の拡散作用による。図6のPd-Ag合金によっては水素拡散（Pd-Ag）： $\text{H}_2 + \lambda\text{H}$ 、Au側： H_2 。

cyclohexeneを入射した、(1)の反応が進行する。

3. 活性化エネルギー -4.85 kcal/mole となる。

H_2 と $\text{L} = \text{Pd-Ag}$ 、Au中で吸収し、Au上へ脱離 H_2 + cyclohexene \rightarrow $\text{L} + \text{Au}$ 。

図6



大変簡単な装置：左の2つま、右の、興味ある方法原論文を見よ。左の表面には $\text{L} + \text{Au}$ の層があるため、一般的な注入法等では適用されない。

川路和津治郎 表面の物理（丸善、オーバスコア - ブラジル 34 - 2-11, 1977）

[文献]

- 1) T. E. Maden : Surf. Sci. 36 (1973) 281.
- 2) C. R. Helms, H. P. Bonzel and S. Melamari : J. Chem. Phys. 65 (1976) 1773.
- 3) P. W. Tamm and L. D. Schmidt : J. Chem. Phys. 54 (1971) 4775.
- 4) S. L. Bernasek and G. A. Somorjai : J. Chem. Phys. 62 (1975) 3149.
- 5) T. V. Vorburger, D. R. Sandstrom and B. J. Wadawski : Surf. Sci. 60 (1976) 211.
- 6) R. DiFoggio and R. Gomer : Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 1258.
- 7) B. J. Wood and H. Wise : J. Catalysis 5 (1966) 935.

1.はじめに

ディソーブション(脱離)とは、固体表面に吸着した不純物原子が、熱刺激、粒子線照射等の刺激により、固体表面から離れ、真空中に飛び出す現象を言う。この現象は、核融合炉第一壁-プラズマ相互作用に及ぼす影響は、大きく分けて2つある。その一つは、第一壁表面に吸着したO, CO, H₂O, CH₄等が、プラズマからの中性粒子、イオン、電子、電磁輻射等の照射を受け、第一壁からプラズマ中に不純物として入る過程であり、プラズマ中の不純物の混入という観点から重要視されてい。もう一つの過程は、第一壁表面に吸着したD, T等の燃料ガス原子が、同じくプラズマからの粒子、電磁輻射により、第一壁からプラズマ中に入り退避²である。この退避は、プラズマ中の電子ビーム、エネルギー-ビーム等に大きな影響を及ぼし、燃料ガスリサイクリングの観点から、その解明が急がれていた問題である。このようにディソーブション過程は、核融合炉第一壁の表面過程として、重要な位置を占めていたが、その解明はまだ十分なものだけでは、以下では、燃料ガスリサイクリングの観点からディソーブション過程を概観する。

2. 核融合炉第一壁における種々の脱離過程

脱離過程として、多くの研究者によつてよく研究されていけるのは、熱脱離過程である。熱脱離過程は、核融合炉第一壁表面上でも当然起こつていいが、ここでは核融合炉第一壁で物理的力他の過程について述べる。

(1) イオン衝撃脱離

これは、第一壁にプラズマから入射するイオン(主に中性粒子)によって惹起される脱離現象である。考えらる得る機構として、次の3つが提案されてい。 (a) 不純物原子が入射イオンから直接運動量を受け取り、固体表面を反射して真空中に飛び出す。(b) 入射イオンが固体表面を反射した後、吸着原子に衝突し、真空中に押し出す。(c) 入射イオンによりスピッタリングが起り、スペッタされた粒子が吸着原子を押し出す。以上のようにイオン衝撃脱離による過程は多く、定量的解明をさかしくしている。イオン衝撃脱離の面積の測定は、高融点金属について多くなされており、 10^{-4} ~ 10^{-7} cm^2 程度にわたつて、衝突断面積は、入射イオンの質量が大きいほど、大きくなる傾向がある。しかし入射エネルギーに対する依存性は単純でなければ、入射エネルギーが大きくなると、衝突断面積が大きくなる場合と逆に小さくなる場合がある。

(2) 電子衝撃脱離

電子衝撃脱離の場合には、吸着原子は入射電子により非熱平衡状態に惹起され、固体表面から真空中に飛び出す。電子衝撃脱離の面積は、ゆうて報告した東にあつては、 10^{-7} cm^2 程度、多く報告した東では 10^{-21} ~ 10^{-19} cm^2 程度である。ある種の半導体表面では、電子衝撃脱離の散度方向に逆の方向性が見出されてい。

(3) 光衝撃脱離

光によって脱離する場合には、熱効果と量子効果が考えられる。熱効果の場合は、熱効率による脱離と全く同様になる。量子効果には、光と吸着原子の直接相互作用、光によって発生したフォトニによるもの、発生した光電子による電子衝撃脱離などが考えられており、光衝撃脱離過程に限らずデータは少ないが、 $10^{-18} \sim 10^{-20} \text{ cm}^2$ である（以下で3.3を参照）。

以上述べた過程のうち、燃料ガス・リサイクリングにどの過程が一番寄るのでしょうか、Wilson¹⁾が調べた結果を 第1表に示す。入射粒子束、特に入射フォトン束等に位置性があるため、正確には評価できないが、イオン（Dが荷電変換中性粒子）による脱離が、燃料ガス・リサイクリングに最も寄るようである。

Incident Particle	Cross Section (cm ²)	Incident Flux (cm ⁻² s ⁻¹)	Desorbed D / Adsorbed D
D	10^{-16}	10^{16}	1
electron	10^{-17}	5×10^{16}	0.5
photon	$10^{-20} - 10^{-18}$	10^{18}	0.01 - 1

第1表 ステンレス表面上の光衝撃脱離に関する評価¹⁾

3. 今後の課題

最近グラファイト等の、いわゆる重原子番号材料が、リミター、アーマー材の有力候補として注目されており、しかし重原子番号材料の脱離に関するデータは極めて少なくて、これに関するデータの蓄積が急がれる。

光衝撃脱離に関する知見が著に不足している。実際過程に關する知見だけではなく、第一壁表面に入射する光の強度、分布等に關するデータも、十分でないと言ふのがだ。

脱離および吸着は、スペッタリング等に比べると、表面状態には確かに大きく依存する。一方融合炉第一壁の表面は、スペッタリング、ブリスタリング等のために、それが、粗面等が、日々刻々変化していく。このようなくずれた表面についての脱離・吸着に關する知見はまだほとんどないが、このようなくずれた表面には、実際の核融合炉の中で、燃料ガス・リサイクリングがどのようにかかる、正確に評価することは不可能である。この点は、燃料ガス・リサイクリング過程を明らかにする上で、今後大きな課題となる。

以上、脱離過程と燃料ガス・リサイクリングの関連について簡単に述べたが、現在プラズマ研究会の企画情報センターの作業委員会において、脱離過程に関するデータの取りまとめを行なっており、昭和56年度末までに報告が発刊される予定であるので、詳細はそちらで参照された。

(参考文献)

1) K. L. Wilson, presented at Topical Meeting on Nuclear Fusion Materials, Seattle, 1981

化学スパッタリング
(固体表面での水素粒子の化学反応)

原研 西室 雅博, 山田 龍司

1. はじめに

固体をイオン衝撃した際、固体表面で化学反応が誘起され揮発性のガス分子を生じる結果、カスケード衝突から予想されるスパッタリング収率より10～100倍程度大きいスパッタリング収率を示す現象が観測されている。この現象は、カスケード衝突に起因した物理的スパッタリングと区別するために、化学スパッタリングと呼ばれており、半導体集積回路製造のドライプロセス技術において、あるいは、プラズマ試験装置のプラズマ壁相互作用において重要な研究課題となっている。

プラズマ試験装置において重要な事は、プラズマを構成する水素あるいは、水素の同位体(D, T)がそれ自身化学的に活性な粒子であるため、プラズマを取り囲む第一壁表面を水素が衝撃すると、第一壁表面において水素との間の化学反応が誘起されて、揮発性のガス分子を生じるということであるが、その重要性が指摘されたのは、約20年前である[1]。最近、プラズマ容器の清浄化に、水素の放電が利用されているが、これは、化学的に活性な水素と金属表面に吸着している炭素や酸素などの間の化学反応によって、プラズマ容器から逃出し易い揮発性のメタンや水が生成されることを利用している[2-4]。

一方、プラズマ試験装置の大型化や、放電持続時間の長時間化に伴なって、プラズマ不純物としての許容量を大きく取ることができるという立場から、高融点材料であり、かつ、低原子番号材料と考えられる各種黒鉛、炭化物あるいは酸化物などを第一壁へ応用する提案がなされている[5]。これらの材料は、化学的に活性な水素との化学反応によって、侵食を受けると予想されるため、核融合炉壁環境下において、どの程度の侵食を受けるのかを評価することのできるデータの蓄積が必要とされる。本稿では、水素と炭素の系における化学スパッタリング現象を中心として述べ、さらに、二元系材料で予想される問題点について、少しふれることとする。

化学スパッタリングを内容の一部として含む総説が、プラズマ壁相互作用については、McCrackenとStott[6]により、また、スパッタリングについては、志水ら[7]により、書かれているのでそれぞれの文献を合わせて参照していただきたい。

2. 炭素材料と水素との間の化学スパッタリング

水素と炭素の系については、熱力学的な立場から、古くから研究対象となっており、文献集[8]も出されているが、核融合炉用データとして、高エネルギーの水素イオンビームあるいは、十分制御された原子状水素ビームを用いたビーム実験が行なわれたのは、ここ10年程の間である。炭素材料は、水素の照射を受けると、主として揮発性のメタンを生成し、損耗する。損耗量は、生成したメタンの量あるいは、メタン生成によって損耗した炭素材料の重量減少を測定することによって通常得られてい

る。

水素と炭素の系において、確認されている事柄を以下に箇条書きにする。

- (1) メタン生成に寄与する水素は、水素分子ではなく、解離した水素原子である。[9-11]
- (2) メタン生成率、および炭素材料の損耗率は、特長的な温度依存性を示し、500°C~600°Cの間で最大となる。(Fig. 1, 2) [9-21]
- (3) メタン生成は、炭素材料の内部ではなく、表面で起る。[15, 17]
- (4) 高エネルギー水素イオン照射による損耗率は、熱エネルギーの原子状水素照射によるそれに比して、約二桁以上大きい。(Fig. 1)
- (5) メタン生成率は、特長的なエネルギー依存性を示し、1 keV付近で最大となる。[21]
- (6) メタン生成率は、高エネルギー水素イオン照射の場合、照射の初期には材料依存性（履歴依存性）を示すが、照射量の増加と共に平衡状態に達し、平衡状態におけるメタン生成率の材料依存性は小さい。一方、熱エネルギーの原子状水素照射の場合、メタン生成率は、顯著な材料依存性を示す。(Fig. 2, 3, 4) [11, 21]
- (7) 800°C以上では、アセチレンあるいはプロパンの生成が観測された例と、観測されなかった例の両方が報告されている。[11, 12, 22]

従って、炭素材料における高エネルギー水素イオンによる化学スパッタリング過程は、以下のように考えて、よいであろう。keV程度の水素イオンの飛程は、 10^3 Å程度なので、打ち込まれた水素原子が、表面で化学反応するためには、飛程付近の深さから表面まで拡散しなければならない。そのため、メタン生成率は、水素イオン照射開始から徐々に増加し、平衡値に達するまでに時間を要する(Fig. 4)。また、この所要時間は、水素イオンのエネルギーおよび照射温度に強く依存する。表面まで拡散してきた水素原子は、その大部分は、表面で再結合して水素分子となり脱離するため、メタン生成に寄与する水素原子の割合は、最大で、約10%程度である。しかしながら、打ち込まれた水素原子のうち反射する粒子以外は、100%捕獲され、拡散過程を経て化学反応に寄与することができるため、吸着確率の小さい熱エネルギーの原子状水素照射に比して、二桁以上大きい損耗率を示すのであろう。メタン生成率が600°C以上で減少する原因是、メタン生成に寄与する水素原子の表面での滞在時間が短くなるためと推測されているが、さらに高温で生成される生成物を含めて、損耗率の温度依存性を説明する必要があろう。メタン生成率が、1 keV付近で最大となる原因については、はっきりはわかっていない。メタン生成率の温度依存性には、水素の同位体効果が見つかっている(Fig. 5) [15]が、エネルギー依存性に対して同位体効果がどのように現われるのか興味深い。以上の事柄に加えて、原子状水素を炭素材料に照射しながら電子 [23]、あるいは、高エネルギーの水素イオン [24]を同時に照射する実験が試みられ、メタン生成機構のより詳細な知見が得られている(Fig. 6)。

3. 二元系材料(炭化物、酸化物)と水素との間の化学スパッタリング

いくつかの炭素化合物と水素の系に関して、損耗率およびメタン生成率が測定されている。

Fig. 7は、B₄CおよびSiCからのメタン生成率を示したものであるが、炭素の場合と類似した特長

的な温度依存性を示している。メタン生成率が最大となる温度は、それぞれ、B₄Cが200℃、SiCが500℃である[12]。しかしながら、SiCの場合、重量測定により、室温から600℃の温度範囲で損耗率が得られているが、温度による損耗率の違いは、非常に小さい[13, 25](Fig. 8)。一方、TiCの場合には、重量測定による損耗率[26]と、メタン生成率[27]とは、比較的良い一致を得ており、二元系材料の複雑さが示唆される(Fig. 9, 10)。SiCの場合、水素イオンの照射によって表面組成の変化することが、示されている[25, 28]。酸化物における化学スパッタリングの報告例は、まだないと思われるが、水素イオン照射による表面組成の変化が報告されており[29]、炭化物と同様、今後の研究が望まれる。

文 献

- [1] V.A. Simonov, B.N. Shvilkin and G.P. Kutukov, in *Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research* (Proc. Conf. Salzburg, 1961) Nucl. Fusion Supplement Part I, IAEA, Vienna (1962) 325; AEC-tr-5589, p.141
- [2] L. Oren and R.J. Taylor, Nucl. Fusion 17 (1977) 1143
- [3] TFR Group, J. Nucl. Mater. 76/77 (1978) 587
- [4] R.J. Taylor, ibid., 76/77 (1978) 41
- [5] L.H. Rovner and G.R. Hopkins, Nucl. Technol. 29 (1976) 274
- [6] G.M. McCracken and P.E. Stott, Nucl. Fusion 19 (1979) 889
- [7] 志水篤一, 山村泰道, 松波紀明, 麻田健治, 西島雅博, 伊藤憲昭, 應用物理, 50(1981) 470
- [8] R.A. Krakowski and D.R. Olander, ERDA Report UCRL-19149 (1970)
- [9] B.J. Wood and H. Wise, J. Phys. Chem. 73 (1969) 1348
- [10] R.K. Gould, J. Chem. Phys. 63 (1975) 1825
- [11] M. Balooch and D.R. Olander, J. Chem. Phys. 63 (1975) 4772
- [12] C.M. Braganza, G.M. McCracken and S.K. Erents, in *Plasma-Wall Interactions* (Proc. Int. Symp. Julich, 1976), Pergamon Press, Oxford (1977) p.257
- [13] J. Roth, J. Bohdansky, W. Poschenrieder and M.K. Sinha, J. Nucl. Mater. 63 (1976) 222
- [14] N.P. Busharov, E.A. Gorbatov, V.M. Gusev, M.I. Guseva and Yu. V. Martynenko, ibid., 63 (1976) 230
- [15] S.K. Erents, C.M. Braganza and G.M. McCracken, ibid., 63 (1976) 399
- [16] B. Feinberg and R.S. Post, J. Vac. Sci. Technol. 13 (1976) 433
- [17] C.M. Braganza, S.K. Erents and G.M. McCracken, J. Nucl. Mater. 75 (1978) 220
- [18] J.N. Smith Jr. and C.H. Meyer Jr., ibid., 76/77 (1978) 193
- [19] K. Sone, H. Ohtsuka, T. Abe, R. Yamada, K. Obara, O. Tsukakoshi, T. Narusawa, T. Satake, M. Mizuno and S. Komiya, in *Plasma-Wall Interactions* (Proc. Int. Symp. Julich, 1976), Pergamon Press, Oxford (1977) p.323
- [20] T. Abe, K. Obara and Y. Murakami, J. Nucl. Mater. 91 (1980) 223
- [21] R. Yamada, K. Nakamura, K. Sone and M. Saidoh, ibid., 95 (1980) 278
- [22] G.J. Thomas, W. Bauer, P.L. Mattern and B. Granoff, *Radiation Effects on Solid Surfaces* (M. Kaminsky, Ed.) *Advances in Chemistry Series* 158 (1976) 97

- [23] C.I.H. Ashby and R.R. Rye, J. Nucl. Mater. 92 (1980) 141
- [24] R. Yamada, K. Nakamura and M. Saidoh, ibid., 98 (1981) 167
- [25] K. Sone, M. Saidoh, K. Nakamura, R. Yamada, Y. Murakami, T. Shikama, M. Fukutomi, M. Kitajima and M. Okada, ibid., 98 (1981) 270
- [26] F. Brossa, J. Bohdansky, J. Roth and A.P. Martinelli, ibid., 93/94 (1980) 474
- [27] R. Yamada, K. Nakamura, K. Sone and M. Saidoh, to be published
- [28] T. Yamashina, M. Mohri, K. Watanabe, H. Doi and K. Hayakawa, J. Nucl Mater. 76/77 (1978) 202
- [29] H. von Seefeld, R. Behrisch, B.M.U. Scherzer, Ph. Staib and H. Schmidl, in Atomic Collisions in Solids (Proc. Int. Conf. Moscow. 1977)

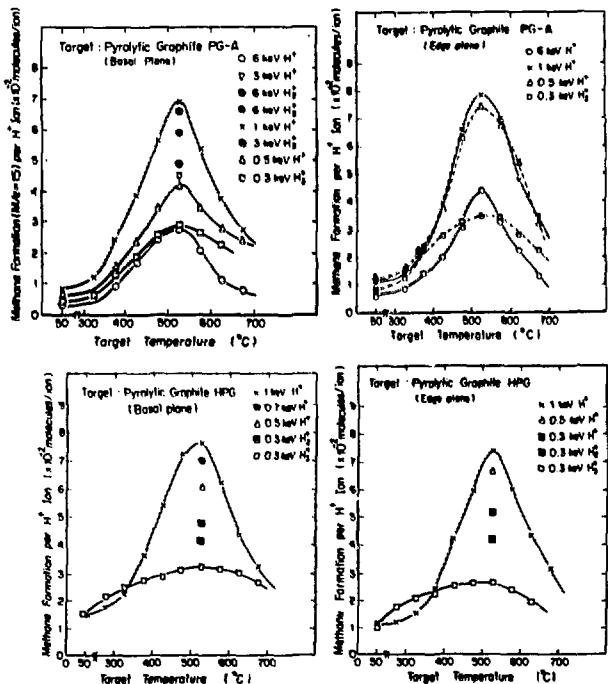
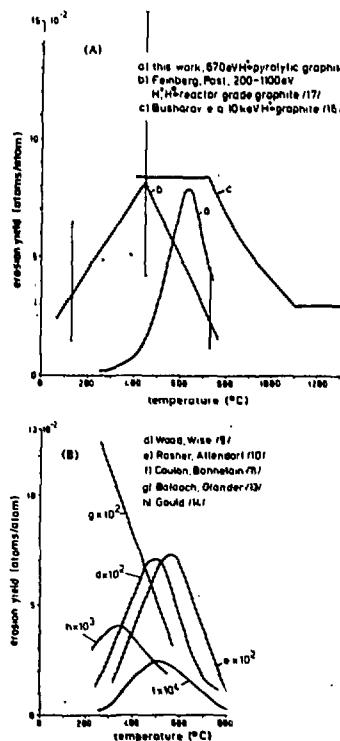


Fig. 1
Temperature dependence of the erosion yield of carbon with hydrogen measured by different authors, (A) for energetic hydrogen ions, (B) for hydrogen atoms at thermal energies (13).

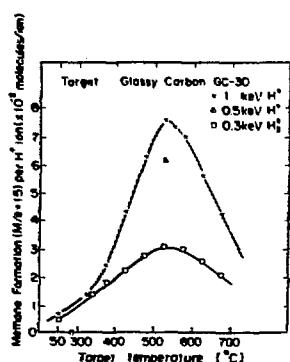
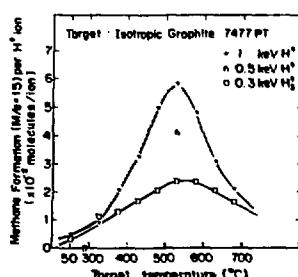


Fig. 2 Temperature dependence of the methane formation rate of various types of carbon bombarded with hydrogen ions with various energies (21).

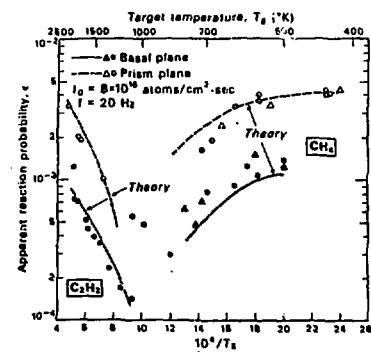


Fig. 3 Temperature dependence of the formation rate for methane and acetylene of graphite bombarded with atomic hydrogen at thermal energies [11].

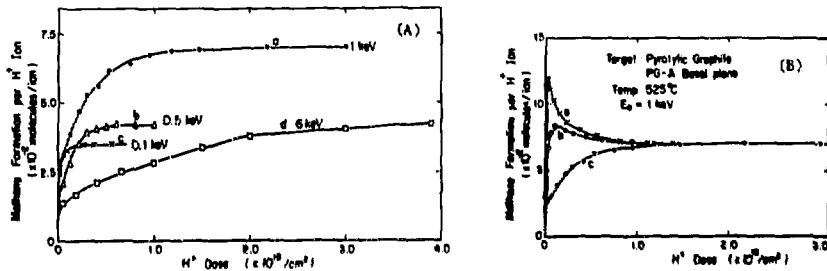


Fig. 4 Dose dependence of methane formation [21].

(A) Effect of incident energy. Targets of a, b and c were the basal plane of pyrolytic graphite and target of d was the edge plane of pyrolytic graphite.
 (B) Effect of pretreatment of target. (a) Prebombarded to a fluence of 9×10^{17} H/cm² with 1 keV at room temperature. (b) Heated up to 700°C and cooled down to 525°C after prebombardment to a fluence of 9×10^{17} H/cm² with 1 keV at room temperature. (c) No treatment.

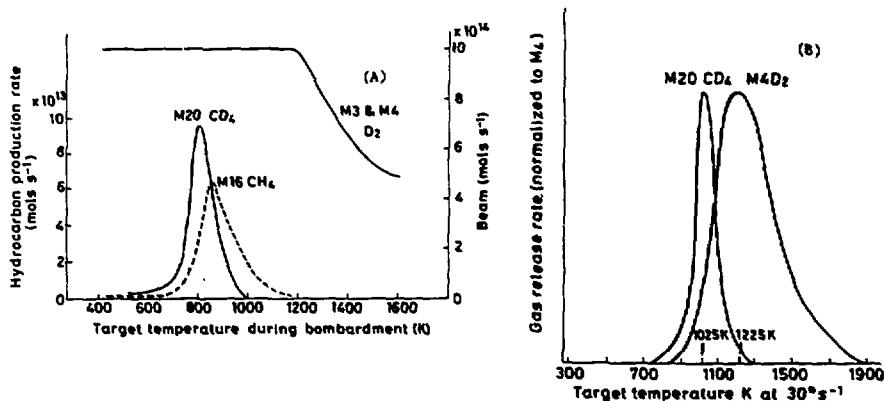


Fig. 5 Methane and deproto-methane formation rate as a function of target temperature [15].
 (A) During bombardment. (B) After bombardment.

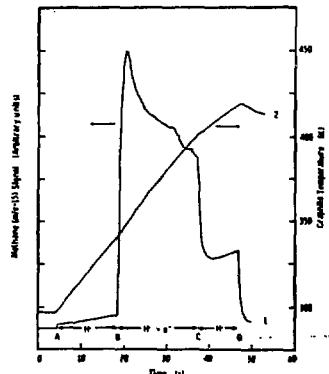


Fig. 6
Effect of electron bombardment on methane formation and target temperature [23]. Curve 1 : Methane signal. At A, atomic hydrogen generation is initiated. At B, electron bombardment is initiated. At C, electron bombardment ceases. At D, atomic hydrogen generation ceases. Curve 2 : Macroscopic target temperature.

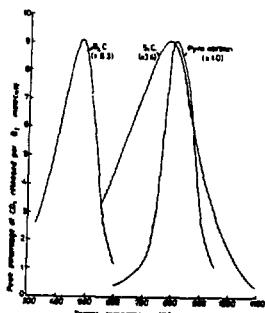


Fig. 7
Temperature dependence of deutero-methane formation rate due to 20 keV D^+ ion bombardment [12].

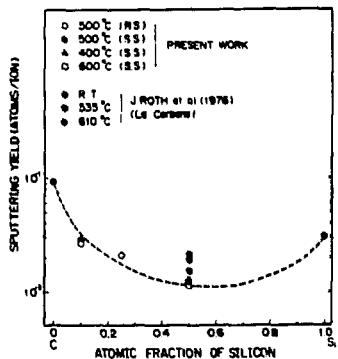


Fig. 8
Erosion yield of SiC as a function of the atomic fraction of silicon [25].

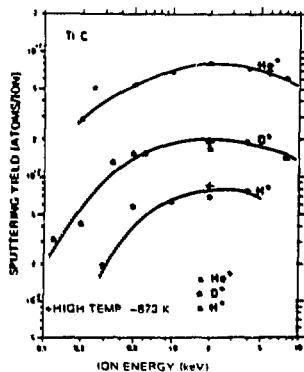


Fig. 9
Erosion yield of TiC as a function of energy [26].

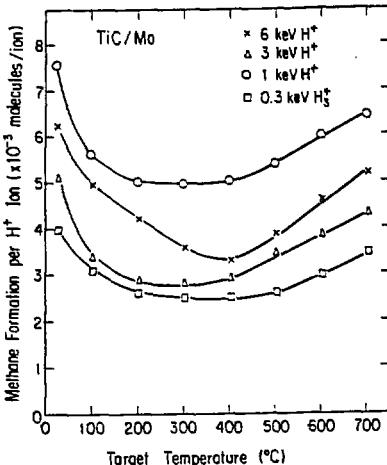
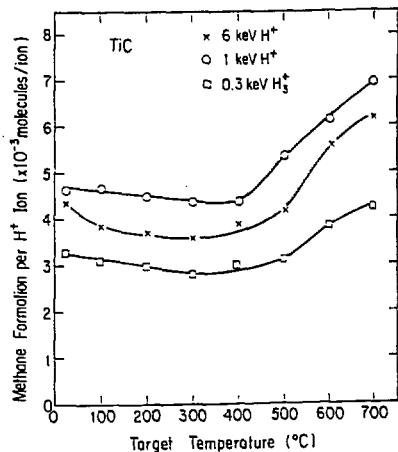


Fig. 10 Temperature dependence of methane formation rate of various TiC [27].

Trapping および Re-emission

阪大工田辺哲郎

[序]

核融合炉オーバー壁における水素の Recycling 現象を明らかにする上で、材料中に打ち込まれた水素イオンのその後の挙動を知ることは非常に重要な問題である。特に入射水素イオンのうち材料中にどれだけの水素が残り (Retention)、どれだけが再放出される (Re-emission) かは、プラスマ壁相互作用を考える上で最も黒色の課題であると言えよう。⁽¹⁾ 水素の Recycling に関してはすでにいくつかの解説や総合報告書が発表されているが、本稿では特に金属材料に打ち込まれた水素イオンの Re-emission および Retention について研究の現状及びその問題点を考えてみたい。

水素イオンを用いた Recycling の研究では、金属中の水素の挙動であることはとくに解明されていないのが現状であるうえ、水素自身を高エネルギーイオンの形で打ち込んだため、問題はより一層複雑なものとなっている。

図 1 は金属中に打ち込まれた高エネルギー水素イオンの挙動を構成的に示したものである。まず打ち込まれた水素イオンは、そのエネルギーに応じて機械的金属原子あるいは電子との相互作用によりエネルギーを失っていく。(Electronic or Nuclear Energy Loss) この過程では金属上、種々の空隙が引き起こされる。2 体衝突過程を基礎とした衝突理論では、水素は、そのエネルギーが数 eV 以下になった時に、とまつたものとみなされるが、水素の挙動は、この点から見るとこゝエネルギーはまだ十分大きく、完全に熱化されるまでの挙動は、現在のところ全くわかつていない。エネルギーを失って、ほぼ熱化された水素原子は、金属内の水素濃度偏配あるいは熱種配等によって拡散していくが、イオン注入により形成された種々の欠陥との相互作用により、拡散が Enhanced されたり、Trapping 作用により Reduce されたりする。そして表面にでてきた水素原子は、他の表面にある原子と再結合したり、入射イオンによりたたき出されたりして空間へ抜け出しを行く (Re-emission)。

表 1 は、このようないくつかの現象に対する水素イオンの動きを、Re-emission, Migration, Retention の 3 つの観点にわけ、それそれの現象に付随している素過程をまとめたものである。それぞれの大きさを問題であるとともに、相互に深く関連している。

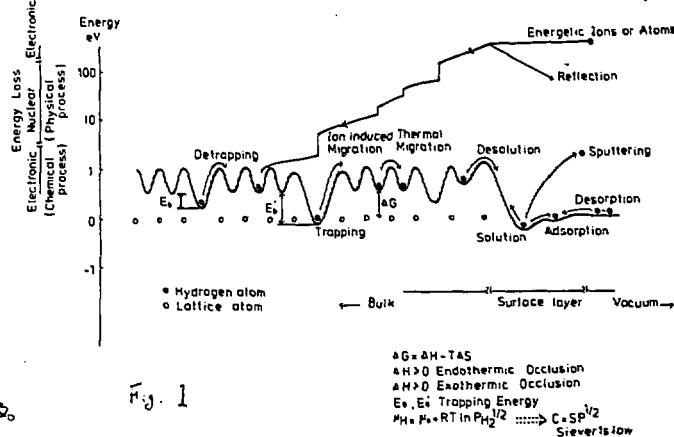


Fig. 1

このようないき過程を考慮して、水素イオン注入下における金属内部の水素濃度の時間変化をModel化すれば次式が得られる。この式を適当な境界条件に従って解けば良いのである。しかし、解析的にも、數値的にも難しいだけである。例えはトランジistorの種類やトランジistorエネルギーなど未知の現象も含

まれており、現在のことごとの現象を全部まとめて計算することは不可能に近い。さらに、照射によって拡散係数が変化したり、ビーム熱負荷による温度偏配、ビームエネルギーに応じたG(x,t)など複数の変化を考慮しなければならぬのである。

ここでは比較的研究の途人である拡散と金属中の水素濃度を中心に実験結果を振り返ってみる。

$$\frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = \nabla(D\nabla C(x,t)) + \frac{Q^* C(x,t)}{RT^2} \text{ Diffusion}$$

$$+ (1-R_E)G(x,t) \quad \text{Source Term}$$

$$- G(0,t)\delta C(0,t) \quad \text{Ion induce Desorption (including Spattering Effect)}$$

$$- k_d S C^2(0,t) \quad \text{Thermal Desorption}$$

$$+ k_{ad} S P_{H_2}^{1/2} \quad \text{Adsorption from Gas Phase}$$

$$- \sum_i \frac{\partial C_i(x,t)}{\partial t} \quad \text{Trapping}$$

$C(x,t)$: Hydrogen Concentration
 $G(x,t)$: Implanted Ion Profile
 $C_i(x,t)$: Concentration of Trapping
 D : Diffusion Coefficient
 Q^* : Heat of Thermotransport
 R_E : Reflection Coefficient
 δ : Desorption Cross-section
 k_d : Desorption Rate
 k_{ad} : Adsorption Rate
 S : Effective Surface Area

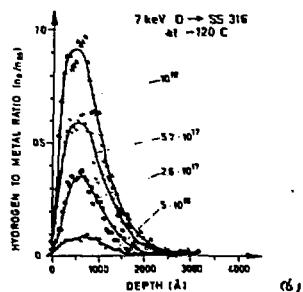


Fig. 1. Concentration of deuterium vs depth below surface at different dose levels for 7 keV implantation of 316 stainless steel at -120°C. (6)

[Retention & Re-emission]

水素の拡散が著しく抑制される低温（ほぼ150K以下）では金属中に打ち込まれた水素イオンは、金属表面層（表面から打ち込まれたイオンの挿入深度附近まで）の水素濃度が、H/M比で約1にならざるを得なくなる。（図2参照）その後さらに照射量を増すと金属表面から水素の再放出が始り、遂には入射Fluxと同じだけの水素が放出される定常状態（100% Re-emission）になる。もう一人図3に示されたように再放出率はじますFluenceが入射エネルギーが大きい程、多い。(5)

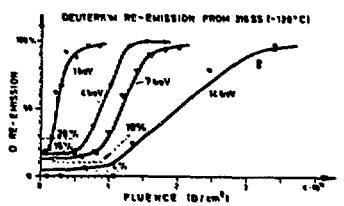


Fig. 2. Re-emission of deuterium as a function of fluence. (5)

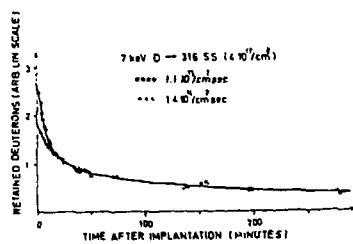


Fig. 4. Deuterium retained in 316 stainless steel in a surface layer of ~400 nm as a function of time after implantation for two different implantation rates. The ^{3}He energy was equal to 0.79 MeV. (4)

Alberter H. et al., Methods 199 (1978) 51

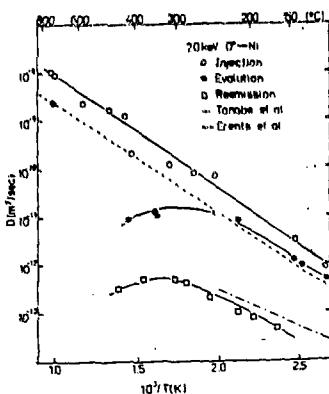


Fig. 5 水素注入・照射下における
Re-emission, Permeation の実験結果と
その他の文献の比較
横軸は通常の注入水素を用いた測定(4) (9)

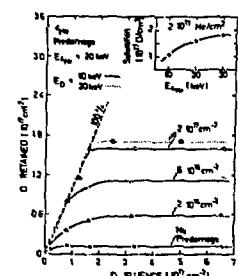


Fig. 6 The total amount of D retained in the near-surface region as a function of D fluence for different He-implantation doses. All measurements performed at room temperature; inset shows desaturation levels as a function of He^+ energy. (1)

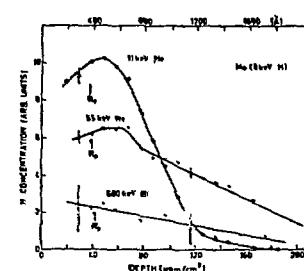


Fig. 7 H profile in Si measured after predamage implantation with He^+ , and deionization at the energies indicated, followed by a 2.5 MeV He^+ implantation with fluences 1×10^{17} cm^{-2} , 2×10^{17} cm^{-2} , 3×10^{17} cm^{-2} and 5×10^{17} cm^{-2} . The arrows indicate LSS projected ranges for the predamage ions. (1)

これに対し、水素の拡散が大きくなる室温以上では現象が複雑になってくる。水素イオン注入初期には水素はすべて Retention されているが、低温の場合より著しく低い Fluence で再放出が始まり、100% Re-emission の状態もより低い Fluence で達成される。この時の水素濃度はステンレスの場合室温で H/Fe が約 0.01 である。⁽⁵⁾ (こゝがこの値は、系内の残留水素分圧から予想される金属中の水素溶解度よりもはるかに大きくなっているだけではなく、照射をやめると同様に示されるように著しく減少してしまつ⁽⁴⁾)。N₂の再放出実験により Events⁽⁶⁾ Tanabe⁽⁷⁾ は表面層での見かけの拡散係数を測定し、この値が通常のそれよりも 2~3 倍大きいことを見出している。しかし、この拡散係数の減少は、都合照射時間による水素のトラップ効果によるものと考えてよい(図 5 参照)。

水素の照射時間によるトラップはあらゆる He やその他のイオノンを打ち込んで次第に導入された試料の水素の Retention の増加によつて明らかであり、(図 6)⁽⁸⁾ またこの場合水素の深さ方向の分布は Predamage により導入された更幅の深さ方向の分布と同じになつてゐる。(図 7)⁽¹⁰⁾

一方、水素放電管気中での水素透過実験によると、放電により水素の透過量が著しく高められる(図 8)。表面での水素濃度が大きくなることは U₂⁽¹²⁾ が示されてゐる。Super-Inventory

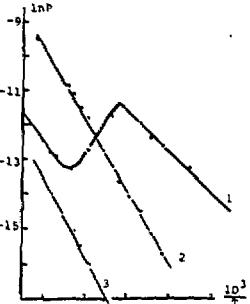


Fig. 8. Temperature dependence of permeation rates for different energetic states of hydrogen. $\delta=0.5\text{nm}$.
1-from glow discharge plasma.
2-atomic hydrogen.
3-molecular hydrogen. (12)

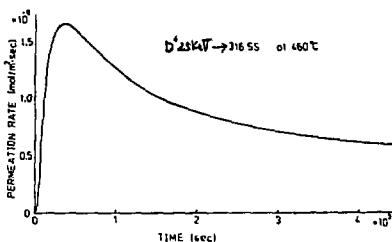


Fig. 9 重水素体 \rightarrow 熱射下において試料D2545で得た
重水素 Flux の時間変化。(13)

Tanabe S が行なったイオン照射下における水素透過実験においてもこの現象は明るかであり、金属中に水素が拡散透過程へ行くのが観察される(図9)とともに、金属内部に蓄積された水素がトラップ作用を受けて、透過量を減少させるこでも見えてれる。また温度によってトラップの効果は複雑に変化し、照射アームの構成等が起つていることを示唆された。(13)

このようにイオニン照射下において金属中の水素は2つの存在状態即ち溶解状態(過飽和含め)及び欠陥によるトラップ状態にあるもの

と考えられる。Thermal Desorptionスペクトルの解析により、ヒットラップモデルによると、(界面により)欠陥の構成等が起れば、この解消も非常に難しくなる。

一方、チタン(Ti)のような水素化物を作りやすい金属では、溶解あるいは水素化物形成による Retention が著しく、文献等によると、ビニング効果は顕著ではない。しかし水素化物が不安定になる高溫では Re-emission 現象は水素化物を作りにくい他の金属(ISSや Ni, Hg 等)とあまり変わらなくなつてく。³

[まとめ]

以上述べて来たように、金属中に打ち込まれた水素の Re-emission, Retention 現象においては、水素の拡散が著しく小さい低温では現象は比較的理解してよく、表面層での水素濃度が 10^{-1} に在れば、両効果があること 100% Re-emission の発生状態になり、金属内部への拡散はほとんど考慮したくていいのに對し、高溫では表面層における水素濃度は、低温に比べて著しく小さいものの、内部への拡散、欠陥によるトラップ等の現象が出現するため、その解析は非常に難しく、ようやく研究の輪に就いたばかりの状況であると言えよう。

[参考文献]

- 1) W. Bauer : J. Nucl. Mater. 26 & 27 (1970) 3-15
- 2) K. L. Wilson : IEEE Trans. Nucl. Sci. Vol. NS-26, No. 1 (1979) 1296-1301
- 3) K. L. Wilson : J. Nucl. Mater. (Santa Barbara) to be published
- 4) C. J. Alstetter et al. : Nucl. Inst. Methods, 199 (1978) 57-63
- 5) R. S. Blewer et al. : J. Nucl. Mater. 76 & 77 (1978) 305-312
- 6) C. J. Alstetter : J. Vac. Sci. Technol. 15 (1976) 706-709
- 7) J. Bahdanavicius et al. : J. Nucl. Mater. 73 & 74 (1970) 594-600
- 8) K. Erentz & G. M. McCracken : Brit. J. Appl. Phys. 2 (1959) 1337-1345
- 9) T. Tanabe et al. : J. Nucl. Mater. (Santa Barbara) to be published
- 10) L. Bottiger et al. : J. Appl. Phys. 48 (1977) 920-926
- 11) R. Besenbacher et al. : J. Nucl. Mater. 93 & 94 (1970) 617-621
- 12) A. E. Gorodetsky et al. : J. Nucl. Mater. 73 & 74 (1970) 588-593
- 13) 国連報 : 日本原子力学会誌 22 (1980) 399-402

核融合炉材料の水素透過と表面効果

東大工、東大原子炉研究組合センター・山脇道大、宮野義一

1. 緒言 核融合炉ア1壁に係る諸問題のうち近年水素リサイクлинの重要性が指摘されるようになった。水素リサイクлинの基礎の甲で、ここでは第1壁材料中の水素透過現象について述べる。これは、水素リサイクリンの重要な因子であるとともに、トトウムの環境放出の面で安全性とも密接な関係を有する。著者らは、透過の基礎現象を理解するため、分子状水素を用いて研究を行つており、本報告においても分子状水素の透過に誰と限らず。

透過研究は直ぐに行はれていゝが、核融合炉の開発からかまど次のようすと見て取れる。不足はない。

- (1) 挑戦はも、ばかり高圧附近の“高圧”での実験が主流であり、核融合炉を考えられる“高圧”での運動はこれまでの“低圧”の外挿には不適である。
 - (2) 当面最も有望な316SSなどでも必ずしも信頼性の高いデータが得られていない。更に先を考へた時、Nb, Tiなどの構成材については、信頼性もさることながら、データ自体が不足してしまった。
 - (3) 表面酸化被覆層の透過に対する障壁効果が多く、データが得られていない。これらを含む、透過の表面効果に関しては、その定量化的現段階は全く未だである。
- 透過現象は本質的に材料中の水素の固溶、拡散を含むので、次章で構成材への水素溶解・拡散のデータを示し、3, 4章で構成材の水素透過性及び表面の影響について述べる。

2. 各構成材中の水素溶解度と拡散係数

2-1 溶解度 金属中へ水素は解離固溶するため、平衡溶解量は平衡固溶領域においては気相圧力の平方根に比例し、これがSatoの法則が成立する。即ち、金属中水素濃度における水素圧力との間に次式が成立する。

$$C = S \cdot P^{1/2} \quad (1)$$

ここで C は水素濃度。

図1に各種金属材料の水素溶解度を示す。尚温における水素吸収量は金属の溶解熱による水素と反応し、相対的水素吸収量が多く、低温では水素化物をつくりやめ。

図2に水素固溶熱と様との関係を示す。²⁾ 1~5族では溶解反応があるが、6~8族

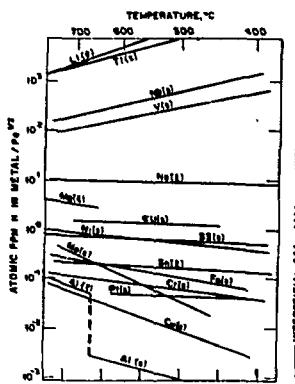


図1. 金属中の水素溶解度¹⁾

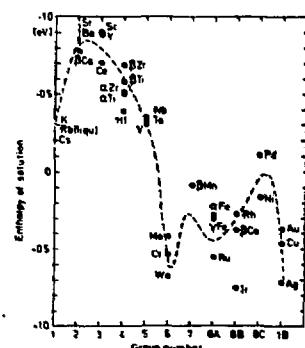


図2. 金属中の水素固溶熱²⁾

ぶよひ／B様は主に吸熱反応である。Nb、T等は発熱型であるが、これらは水素を吸収させて分子の温度を下げると脱化などの問題がある。

2-2 抽散率 金属内部水素は格子間位置を占め、格子間拡散により金属内部運動する。その為金属内部の水素拡散係数は、通常の金属の自己拡散係数などにくらべると非常に大きい。現象的にはフィックの第一法則により次の様に表わされる。

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial K} \quad (2)$$

ニニに、丁は水素沈東、Dは弦歎得數、久は整離。Nb, V, Taの水素弦歎得數を図5に、Mo, Tiの水素弦歎得數を図6に示レ。前者は測定法等の違いによりばうつきが大きさ。後者は前者にくぐり入るべく約10倍の値を持つ。図5に掲載の活性化エネルギーと回転半径の族との関係を示可。最密構造のFCC金属の方がBCC構造のものより活性化エネルギーの大きさこれが見受けられよう。又み図中、黒塗りの点は吸収法や過渡法のように表面の関与する方法で求めた值であることを示してある。図6に丁、Nb, Taの水素弦歎得數の同位元素効果を示す。丁-アム一致性は強めて思へる全体として古典的の同位元素効果(少重量 依存性)から脱れてゐる。

$\varepsilon = 3\%$, 通过量

4. フラクタル被膜の重電性

卷第1壁八八三-71

27 など観点から

Ellerman 与湖险危化合

作物水素吸收率之测定

無鉛レニルとの競争を

图7E至图9，图3，4

などと比較すればわかる

卷之三

金庸武侠世界

八百三十

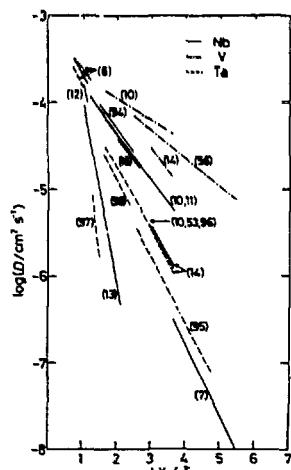
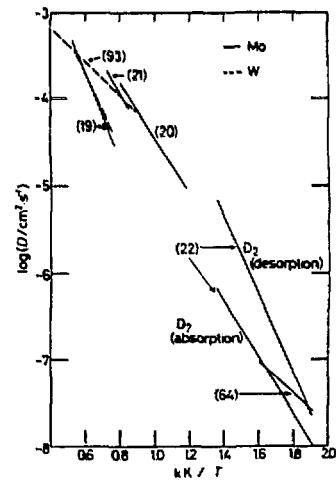


图3 Nb-V-Ta水素吸收率



四、Mo, W 的水素吸收系数

3. 石津村中の水耕

過濾率 金属膜中の水素透過量は(1)のように式で次のように表わされる。

$$J = \frac{S \cdot D}{d} (p_i^{k_2} - p_2^{k_2}) \quad (3)$$

これは試料厚さ、
たるみは試料膜上・下流側
の水素圧力である。

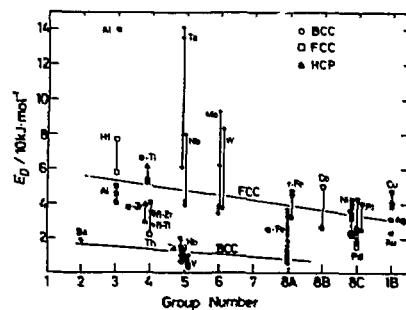
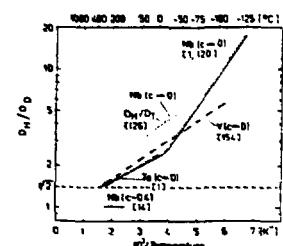


图5 宜宾市水系概况及主要河流



শির্ষ নং V. কৃষ্ণনগুলি প্রকাশ

通常の実験では $p_1 \gg p_2$ と設定するため、(3)は

簡単に

$$J = \frac{S \cdot F}{P} P_1^{1/2} \quad (4)$$

上式の直証、水素通透率 P を $P = S \cdot D \cdot L$ と表すと。

この単位は J の $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{Pa}^{-1/2}$ と書けます。
あるいは $\text{cm}^3(\text{NTP}) \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{Pa}^{-1/2}$ などとも書けます。

データの不確実性に一応目をひく。金属の水素
透過率の相対的位置関係をみると、図8に透過率
の温度依存性を示す。⁵⁾ 大体の傾向はわかろう。

4式は拡散律連が成立するごく单纯な場合の透
過速度式だがこれが成立する場合以外にはない。
代表的例はNi: じつはNiの透過速度の圧力
依存性の方が試料等の依存性を示す。図9、10に示
せた。いずれも(4)も拡散律連のよう成立する
ことを表している。

SSは、⁶⁾ Ferrimori⁷⁾ が他の材料との水素通
透率のグラフを図11に示す。これで見ると各物質の
運動率は必ずしも表面状態によらず、隠れ

ての運動率が表面の運動率と認められる。図12、13はNi_xの透過率と未だ測定範囲の外
のものと大きく。これはも、ほんの表面状態の複雑さによるものと考へられる。これらの金属
の水素に対する酸化物、炭化物極めて難かしく、これがデータのはうでの主原因である。このよう
に金属の水素透過率には表面の影響が非常に重要でありいくつかの透過モデルが提案されてる。
次章では主に表面の運動を中心とした問題を検討する。

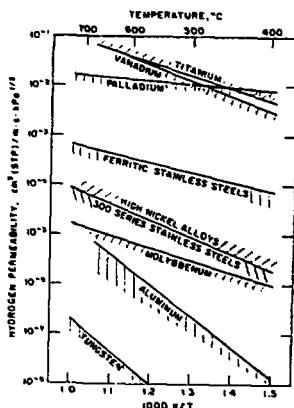


図8. 各種金属中の水素透過率⁵⁾

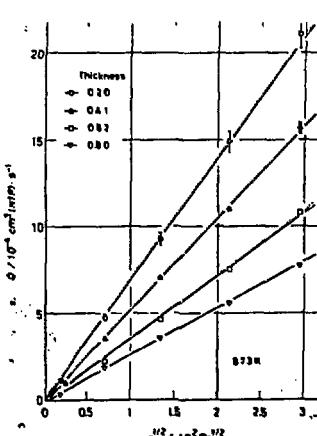


図9. $Ni = 673\text{K}$ の水素透過率⁶⁾
注) 厚さ倍数

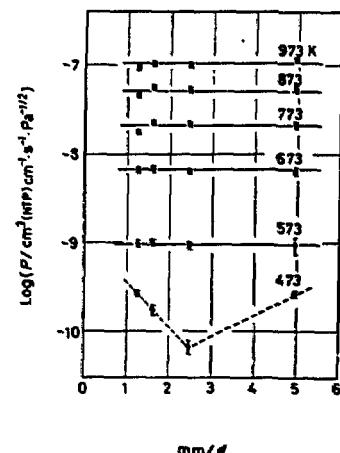


図10. Ni の水素透過率の計算⁶⁾
注) 厚さ倍数

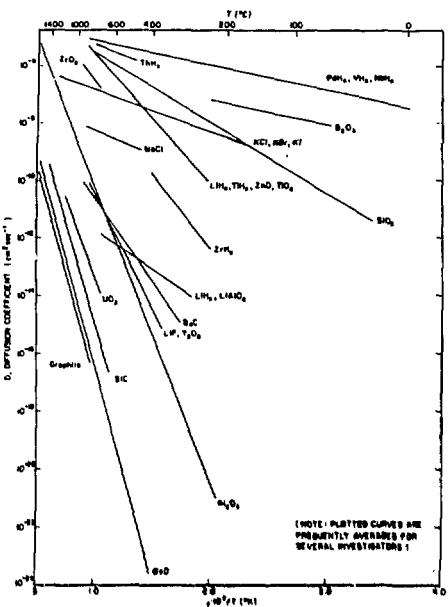


FIGURE 2B1 HYDROGEN DIFFUSION COEFFICIENTS IN NONMETALLIC SOLIDS

図7. 一般化合物の水素拡散係数⁴⁾

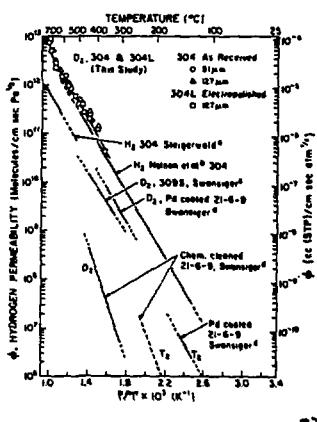


図11. 各種ステンレス鋼の水素透過率

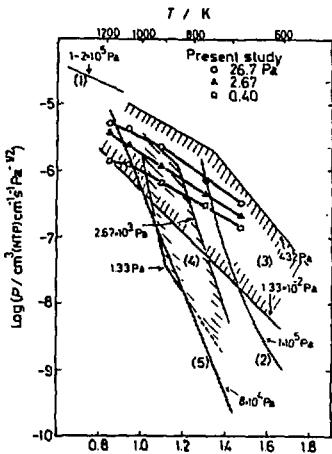


図12. Nbの水素透過率

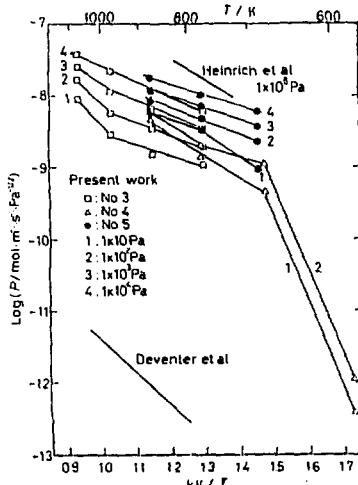


図13. Tiの水素透過率

4. 水素透過性に対する表面の影響 核融合炉により近い条件として低水素圧下での透過性が重要な課題である。図14に著者らの研究室で得た、ニバニウムの水素透過の圧力依存性を示す。低圧では透水量が圧力の1乗に比例し、圧力上昇につれて、直線に近づく傾向を持つ。この傾向はステンレス鋼よりも報告されている。⁵⁾

こうした圧力依存性に対して、Stretchowらは酸化被膜中の水素拡散が分子状とじまとレモアルとつくっている。詳しくは原著⁹⁾をみるが、彼らによれば、透過速度 J は、

$$J = \frac{1}{2} \left[\frac{P}{d} \right]^2 \left(\frac{dx}{Zdx} \right) \left[4\pi \left(\frac{P_{in} \cdot d}{E \cdot dm} \right)^2 P + 1 \right]^{1/2} - 1 \quad (5)$$

と表わされる。ここで、 d は酸化被膜の厚さ、 P_{in} は酸化被膜中の水素拡散係数、他は以前と同じ。(5)式は圧力の極限が無で、次のようになります。

$$P_i \rightarrow \infty \text{ のとき } J = \frac{P}{d} P^{1/2} \quad (6)$$

$$P_i \rightarrow 0 \text{ のとき } J = \frac{P_{in}}{Zdx} P \quad (7)$$

従って低圧では1乗、高圧では直線に比例するという実験結果を見得かずと説明する。

TF被膜中に pore や crack がある場合、さらに高圧では、こうした孔の隙間の拡散が支配的となるが、後述の透過率を計算するモデルを導入しておこう。

図15は304SSの透過データと示すが、上述のモデルによる結果として報告されている。¹⁰⁾

著者らはTiの他Nbでもこのように1→2次過程を観察しており、一方このモデルを詳細に行なった。

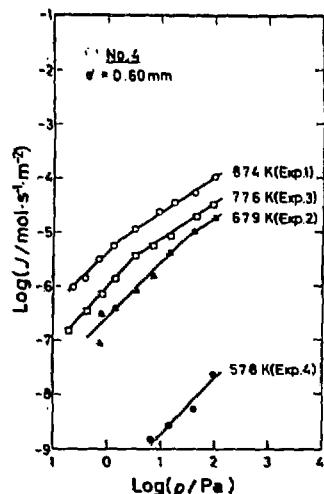


図14 Tiの水素透過率の圧力依存性

しかし、酸化膜内を水素が分子状で拡散することによる溶解
し難い点がある。ことに最近では非金属中の水素溶解度と透
過速度が江川の「未だにはばく比例するデータも得られており¹⁴⁾
最も適切な式である」と思われる。

が、透過程度におよぶ水素の圧力依存性からみれば事実
であり、これは表面が態に変化に帰因するか、あるいは現象
が吸着なし脱着速度に近づいていたか、いずれかと考えて
よきを得ない。現実はこれららの複合したものであろう。

Ali-Kahnらは、清浄表面に対する脱着速度の場合の速度式を求め、數10 Torr程度まで¹⁵⁾水素
圧からがれることを報告している。

一方、Demunterらは、実験装置内壁のみに導入H₂に帰因する不純物を出来を限り低減化させ、
316-SSで10⁻⁴Paの圧力下で水素剤の成立することを示してある。その結果は図6に示した。

著者らはVに2.7%鉄(後試料)のAuger分析を行なう、表面不純物層の厚さの経過速度の大き
さを確認しておいた。最近、in-situのAr⁺スパッタ技術による透過程度に対する影響を調べた。
その実験装置を図17に示す。現在のところ試料上流のナスパッタとしている。400°Cまでの結果を図6に示す。図6は水素導入後の2次側水素量の時間的変化を示したもので、E1-VI、E4-VI、E5-VIはスパ
ッタをしない時のものである。スパッタするといつては常に違う今までの時間が1/3~1/4に短縮化され
る。ところが図6に示すように、通常透過程度は初期のE1、E2は別としてスパッタの有無にかかわ
らず大体等しい値を示している。これらの点に注目すれば、すでに研究中であるが、下流側のスパッタを
行なうことにより表面不純物の影響がどの程度かかるかと見制せしむる。

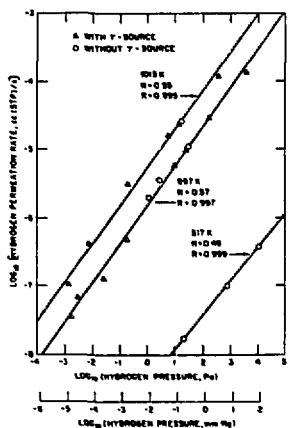


図16 316-SSの水素透過程度
圧力依存性¹⁶⁾

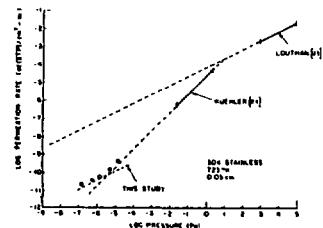


図15 304-SSの水素透過程度の圧力依存性¹⁰⁾

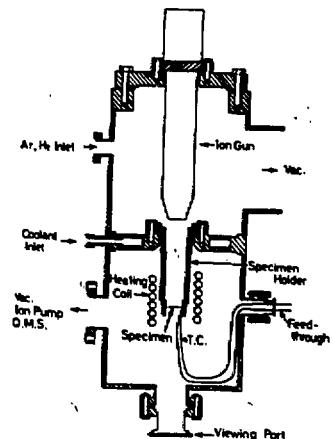


図17 水素供給装置を用いた
水素透過程度装置

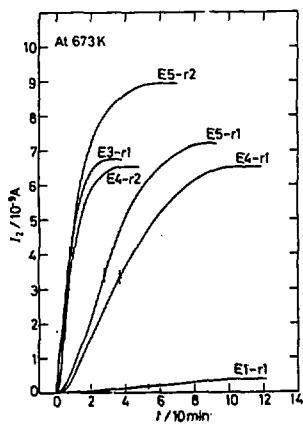


図18. 水蒸気透過性(温度: 673 K)
Alスputtered試料(E1-r1, E2-r1, E3-r1, E4-r1, E5-r1, E5-r2) 試料T.

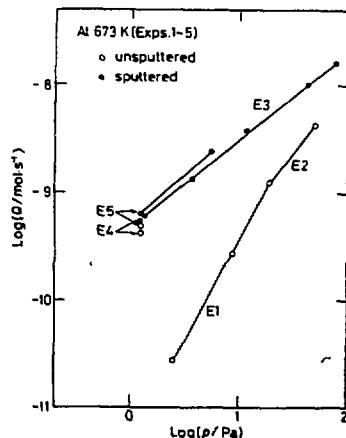


図19. 水蒸気透過性(温度: 673 K)
の影響、試料T.

5. 結論

以上述べたように、水蒸気透過性に対する表面の影響は複雑であることがわかった。複雑である。一例に表面汚染のコロナール、酸化物、炭素などの場合、今後 in-situ cleaningなどとともに導入 H₂ の不純物を揮発可能領域を表面に導入して工夫し、難易度を下げたい。in-situ による表面観察技術の手法を利用して表面の水蒸気透過性を行なうなどの研究が今後進むこと。

文献

- 1) V.A. Maroni and E.H. Van Denuter, J. Nucl. Mater. 85 & 86 (1979) 257.
- 2) R.B. McLellan and W.A. Dales, Acta. Met. 21 (1973) 181.
- 3) J. Völkel and G. Alfeld, In Hydrogen in Metals I, Basic Properties, Topics in Applied Physics, Vol. 8 (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1974) p. 321.
- 4) T.S. Ellman, D. Rao, K. Verghese and L. Zumwold, Hydrogen Diffusion, Dissolution and Formation of Nonmetallic Solids, Contract No. DE-AS05-76-ET52022, (1970)
- 5) 文献 1) 参照
- 6) 東京電機大、小林徳也、山野道夫、藤原昌義、日本金属学会誌 42 (1978) 374
- 7) H.K. Perkins and T. Doda, J. Nucl. Mater. 71 (1978) 349
- 8) M. Kanno, M. Yamawaki and T. Nambu, Proc. 5th JIMIS-2, Hydrogen in Metals, Supplement to Trans. JIM. 31 (1980) 105
- 9) R.A. Strehlow and H.C. Savage, J. Nucl. Mater., 53 (1974) 323
- 10) A.S. Zarchy and R.C. Aitmann, J. Nucl. Mater., 29 (1979) 110
- 11) I. Ali-Khan, K.J. Dietz, F.G. Woolcock and P. Wienhold, J. Nucl. Mater., 76 & 77 (1978) 337
- 12) E.H. Van Denuter and V.A. Maroni, J. Nucl. Mater., 92 (1980) 103

参考文献

水素透過の一般的な review は少くないが、次の二つが主である。

- a) R.E. Stickney, Diffusion and Permeation of Hydrogen Isotopes in Fusion Reactors, in *The Chemistry of Fusion Technology*, D.M. Gruen ed. (Plenum Press, New York, N.Y. 1972) p.241
- b) 吉田平太郎, 岩井清二, 日本金属学会報 7 (1972) 533
a)は金属材料中の当原子で H^+ - D^+ の拡散係数と H_2 , D_2 の半径に関するもの。

拡散は H^+ - D^+ と H_2 とで大きな差がある。

- c) J. Volkl and G. Hiefield, In *Diffusion in Solids, Recent Developments (Materials Science Series)* ed. by J.S. Nowick and J.J. Burton (Academic Press, New York, 1975) p.231
 - d) G. Hiefield and J. Volkl (eds.), *Hydrogen in Metals I, Basic Properties, Topics in Applied Physics*, vol.28 (Springer-Verlag, Berlin, 1978)
 - e) G. Hiefield and J. Volkl (eds.), *Hydrogen in Metals II, Application-Oriented Properties, Topics in Applied Physics*, Vol. 29. (Springer-Verlag, Berlin, 1978)
 - f) 金属学会日誌 - 付録, 金属と水素 (日本金属学会編) (1976)
これは 1975 年度までの金属中の水素同位体濃度を算定し表にまとめたものである。 H^+ - D^+ の拡散係数は $10^{-12} \text{ cm}^2/\text{sec}$ である。
- 1) 重心の基準で計算した場合の拡散係数 D_{H^+} "Diffusion of Hydrogen in Metals" の値との関係性はほとんど変わらない。溶解濃度は $10^{-12} \text{ mol}/\text{cm}^3$ の H^+ と D^+ の濃度である。
- 2) 水素化物や水素吸蔵によるものと中心となる。Next 5 から 7 の間では計算される。
- 3) 溶液と金属との水素脱離などの点で異なる。

水素の拡散

広島大 理 紀 隆雄

核融合研究の立場から水素の拡散を取り上げる場合、先づ問題になるのは炉壁材料中の拡散である。特にオーブンでは水素同位体のリサイクリングおよび残留試射飛の観点から、その拡散過程と制御することは重要な問題である。今一つはノリスター・アボイド形成による表面損傷ないしはスエリングの問題であるが、これには必ず炉壁に入射するエネルギー粒子により形成される原子空孔等の点欠陥の集合過程が関与しており、その点欠陥の一つがHやHe等のリマント缺陷である。したがって、単にHの移動度を知るだけでなく、他の不純物など格子欠陥との結合エネルギー等の知見も必要となる。特に原子空孔との相互作用は基礎データとして不可欠のものである。ここでは先づ金属中の水素拡散の特徴とその拡散係数の決定法を概観した上で、金属中の水素トランジスタ効果について述べる。

§1 水素拡散の特徴

オーブンは主なる金属材料中の水素(H)と重水素(D)の300°Cでの拡散係数の大体の値を示してある。その温度での純金属の自己拡散の係数に比べて十数倍も高いばかりでなく、同じ格子間不純物であるOやNのジャンプ数に比べても十倍以上も多い。このような大きな拡散係数はその活性化エネルギーが0.1 eV程度と小さいことに起因している。したがって水素の拡散は可成りの低温でも認められており、量子効果が期待される。また水素には重水素、三重水素の同位体が存在するから、その質量差による同位体効果も期待される。またのことから、核融合に不可欠な三重水素の挙動を予想することができると。

金 属	拡散係数 (300°C)	
	H	D
Al	1×10^{-6} cm ² /s	cm ² /s
V	1×10^{-4}	8×10^{-5}
Fe(a)	1×10^{-3}	
Ni	1×10^{-6}	
Nb	5×10^{-5}	4×10^{-5}
Pd	5×10^{-5}	
Ta	3×10^{-5}	2×10^{-5}

オーブン

§2 水素の拡散係数の決定法

水素の拡散係数を測定するには次のような方法がある。

a) 透過法

水素ガス溜と真空容器とを、測定しようとする金属の100 μm程度の薄膜で隔離し、真空容器中に透過していく水素量を何等かの方法で定量すれば、透過の実際速度が得られる。これは水素の拡散係数と固溶度との積の形で表わされる量であるから、ある温度での拡散係数を知らなければ、その温度での固溶度を知る必要がある。最近では透過した水素の定量には感度の高い半導体分析計がよく用いられる。

同じ透過法でも、ガス溜に水素を導入した直後や、或は水素を減圧した時に透過速度が高まること

より過渡的)過程するから非定常は過程から、いかゆる Dose - Log 法と用いて拡散係数を決定することもしばしば行われる。いずれの場合にも表面の反応に注意する必要があり、試料の厚みを変えらなどして測るところが望よい。

b) 電気化学的方法

これは過渡法の一変形と言えるもので、例えば NaOH 溶液の中で電気化学的に水素とカソード添加する方法である。本素添加を始めると水素の通過速度に比例してアノード電流が次第に増加して直線に到達する。また水素添加を止めるとアノード電流は次第に減少する。この過渡的な過程を time - lag 法などにより解析する。

c) 内耗による方法

これには大別 I (ニ) の方法があるが、I はヘリ - クピ - クによる方法である。Fe, Nb, V 等の中に C や N 等の格子間不純物原子を少量加えた時に現われる内耗のピークであるが、これが Nb 中の H や D についても見出された。しかしこの場合には H や D による直線のヘリ - クピ - クではなく (C や N にトラップされた水素がその樹りを回転することによって生ずるものである。したがってこれから直接拡散係数を求めることはできないが、不純物原子による H や D のトラップ効果と測るにはよい実験手段である。

I - II はゴルスキ - クリスティによる方法で、金属中に溶けている H はセグメントと抜けるので、H を添加した金属と弹性的に作用すると H は屈筋側から張筋側へ飛ぶ。H の移動速度は大きいので弹性变形に伴う水素の移動が簡単となり測定される。この過程の緩和時間とて、試料の厚さを d とするとき拡散係数は

$$D = \left(\frac{d}{\pi} \right)^2 \quad \text{で表わされる。}$$

この測定法には過渡法と異り、表面の影響が入らないので、真の拡散係数が期待される。

d) 電気抵抗による方法

電気抵抗はやつた性に比べて (測定精度が高いため) しばしば拡散係数の決定にも利用される。線状の試料の一端に水素を添加して、その水素移動を電気抵抗で追跡したり (1)、急速などにより過飽和に添加した H の回復過程と抵抗測定 (追跡するなどして、拡散係数を求める) (2)。しかしこの場合その金属中の水素による電気抵抗を手を離すの知りおへ必要がある。これまでに求められたいわゆる $\mu\Omega \cdot cm / at\% H$ 当りの抵抗値を表 2 表によとめおく。

e) トレー - サーによる方法

三重水素が放射性であることを利かせば、容易に拡散係数が求められる。実験設備に困難はあると (も核融合材料の開発といふ立場では不可欠の方法といふ)。

金属	比抵抗 ($\mu\Omega \cdot cm / at\% H$)		文献
	H	D	
V	0.98	0.90	(3)
Nb	0.65 - 0.75		
Cu	1.50 ± 0.05		(4)
Nb	0.65	0.58	(3)
“	0.64 ± 0.06		(5)
Ta	0.7 ~ 0.9		(6)

表 2 表

この他、核磁気共鳴や、中性子散乱等の実験からも拡散係数は大きがらざれでいる。

§3 水素のトランプ

水素の拡散を考える場合、必ず問題になるのは不純物原子その他のによる水素のトランプである。特に大きな拡散係数をもつ水素では、可成りの低温でもその効果が顕著に現れる。例えば鉄の拡散係数は古くから繰り返し測定されていて、室温附近では高温からの外挿値よりも数倍大きい値が得られている。これは明らかに用いた試料の純度が低いために他の不純物によりトランプされるため、見掛けの拡散係数が低下したものである。トランプがある場合の拡散係数 D_{eff} は次のようになされる。

$$D_{eff} = D(1 + Nk/p)^{-1}$$

ここで D は解離係数、 k は捕獲係数、 N はトランプの数を表すものである。

では実際にトランプとして働く格子欠陥にはどんなものがいるかと列記しておきたい。

a) 原子空孔およびその集合体

古くから Fe, Al, Au, Cu, Ag 等の金属を急速冷却すると原子空孔が集合して小さなボイドが存在することが電子顕微鏡観察から知られていく。過飽和に存在する凍結空孔が集合して原子空孔集合体を形成する場合に、そのまゝ成長して三次元のボイドを作成したり、三次元の集合体が小さい間に潰れて二次元の粒状ループにならなど、空孔集合体の形成過程は単純ではない。これには勿論、安体金属以外の金属不純物も関係するが、H を含めてガス不純物も大きな影響を与えていく。特に H の存在はこのボイドを熱的に安定化するので、ボイドは水素のトランプとして働くことは明らかである。しかし单一の原子空孔についてはそのトランプ効果に余り注目されなかった。ところが最近になってその事実が実験的に確められつつある。

Myers 等 (7) は 99.99% の Fe に 90K で重水素を $1.5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$ 打ち込んだ後、そのまま重水素の焼鍛実験を行った。2K/min の昇温速度で得られる回復過程には 260K と 350~450K に明瞭なステージが見られる。それまでのステージの活性化エネルギーと 1 では 0.48 eV と 0.81 eV を得ている。Fe 中の水素の拡散の活性化エネルギーが 0.05 eV であることと併せて考えると、この二つのステージは何かのトランプによるものとの考えられない。一方チャネリ、アモル断面分析から得られる重水素位置は八面体位置に近いが、最近傍原子位置の方向に $0.4 \pm 0.1 \text{ \AA}$ だけずれてい。以上のことから 260K の回復ステージはイソトローピングの際形成された原子空孔にトランプされた D が解離する過程といえる。また 350~450K のステージは小さい原子空孔集合体或は転位によるトランプからの解離とも考えられる。

一方、Al については橋本らによると過渡実験 (8) から、300~400°C での拡散係数は次のように表わされる。

$$D = 0.26 \exp(-0.61eV/kT) \text{ cm}^2/\text{s}$$

しかし 30°C での直通実験からは $2 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$ の拡散係数が得られており、これは上式を計算して得られる値の 4 衝も大きい。この事実は温度によらず水素の拡散係数が異なることを示唆するもので、水素濃度に比べて原子空孔濃度が低い室温では水素は格子間位置を自由に移動するべく

300°C以上になると原子空孔濃度が高くなると水素は原子空孔にトラップされて対の型で移動するものと考えられる。上式からも判るように水素の拡散の活性化エネルギーが、原子空孔のそれ非常に近いこともそれを裏付けるものである。このモデルによると原子空孔とHとの間の結合エネルギーは0.6 eV以上になり、電子論から予想される大きな結合エネルギーともよい一致を示している(9)。

b) 不純物原子

一般にN, O, Cのような格子間位置に入るもの不純物によって金属中の水素の挙動が大きく変わることは古くから報告されており、それはこれら不純物による水素のトラップ効果として説明されている。特にV, Nb, Ta等ではトラップ効果により、(水素の固溶量が増すことや、低温で観測される内耗のピークがOやNにトラップされたH、すなわちO-HペアやN-Hペアによることが知られている。このピークは例えばOにトラップされたHがそのまわりを回転することによって生ずるもので、その周波数を変えることにより回転運動のエネルギーを求めたり、温度によるピークの高さの変化からOとH間の結合エネルギーを知ることができる。

また電気抵抗の測定によってもトラップ効果の研究が行われているが、その一例はPfeifferとWipfによるもので、Nb中の格子間位置にあるNは一個のHをトラップし、その結合エネルギーは 0.12 ± 0.02 eVである(5)。このような測定では自由なH原子とトラップされたものとのでは抵抗率が異り、それより抵抗変化と知る必要がある。この場合には自由なHの抵抗率が $0.64 \mu\Omega\text{cm}/\text{at}.\%$ であるにつれてトラップされたHのそれを $0.38 \pm 0.06 \mu\Omega\text{cm}/\text{at}.\%$ としている。

上記のような方法で測定された不純物原子とHやDとの結合エネルギーと、気付いたものだけ拾ったものが次であるが、大体1 eV前後で、最も大きいものが2.3 eVである。なお Yei と McLean (10) はNiに1.5~13.4 at%のVと添加した数種類の合金について、Hの通過率とTime-lag 法で測定し、トラップによるHの移動度の低下は置換位置に入ったV原子による格子の緩和に起因する移動度の増加と打ち消し合うとしている。

系	不純物	結合エネルギー	文献
Al-H	Cu	0.05 eV	(11)
"	Mg	0.06	(11)
"	Mg	0.3	(8)
"	Si	0.1 以下	(8)
V-H	C	0.13	(12)
"	N	0.13	(12)
"	O	0.09~0.13	(12)
Cu-H	unknown	0.12	(4)
Nb-H	N	0.1	(13)
"	N	0.09	(14)
"	N	0.12 ± 0.02	(5)
"	O	0.09	(15)
"	H	0.06	(14)
"	V	0.09 ± 0.05	(16)
Nb-D	O	0.13	(15)
Ta-H	N	0.06 ± 0.015	(17)
Fe-H	Ti	0.27	(18)
"	C	0.03	(19)
"	N	0.12	(19)
"	H	0.04	(19)
Fe-D	D	0.16	(19)

表 3 表

C) 転位その他

転位におけるトラップ^aについては、前記の不純物などの報告はないが、鉄鋼材料では水素脆化の問題があるので可成りの知見が得られてはいる。Orani (20) は水素の吸収放熱および透過のデータから鋼中のトラップ^aにおける結合エネルギーとして 0.27 eV を得てはいる。坂本等 (21) も電気化学的方法によらず透過程験から同じ大きさの結合エネルギーを報告してはいる。ところがすぐ添加した場合には結合エネルギーと 1 (約 2 倍の値) が報告され (22)、未だ確定的のこととはいえない。

この他、粒界や表面近傍でのトラップ^a効果など金属中の水素同位体の拡散にまつては考慮すべき未解決の問題が多く残されてはいる。

参考文献

- 1) D.G. Westlake, S.T. Ockers and D.W. Kegan : J. Less-Common Met. 49 ('76) 341.
- 2) R. Hanada : Scripta Met. 7 ('73) 681.
K. Yamakawa : Japan J. appl. Phys. 16 ('77) 1033.
- 3) D.T. Peterson and C.L. Jensen : Metall. Trans. A9 ('78) 1673.
- 4) W.R. Wampler, T. Schober and B. Lengeler : Phil. Mag. 34 ('76) 129.
- 5) G. Pfeiffer and H. Wipf : J. Phys. F 6 ('76) 167.
- 6) J.A. Pryde and I.S.T. Tsong : Acta Met. 19 ('71) 1333.
- 7) S.M. Myers, S.T. Picraux and R.E. Stoltz : J. Appl. Phys. 50 ('79) 5710.
- 8) E. Hashimoto, K. Ono and T. Kino : Proc. of Yamada Conf. V on "Point Defects and Defect Interactions in Metals" (Kyoto, Japan, 1981).
- 9) Z.D. Popović and M.J. Stott : Phys. Rev. Lett. 33 ('74) 1164.
- 10) W.M. Yei and R.B. McLellan : Acta Met. 28 ('80) 1437.
- 11) M. Leger and G.R. Piercy : Phil. Mag. 43 ('81) 347.
- 12) H.Y. Chang and C.A. Wert : Acta Met. 21 ('73) 1233.
- 13) D. Richter, J. Töpler and T. Springer : J. Phys. F 6 ('76) L93.
- 14) C. Baker and H.K. Birnbaum : Acta Met. 21 ('73) 865.
- 15) R.F. Mattas and H.K. Birnbaum : Acta Met. 23 ('75) 973.
- 16) T. Matsumoto : J. Phys. Soc. Japan 42 ('77) 1583.
- 17) K. Rosan and H. Wipf : Phys. stat. sol. (a) 38 ('76) 611.
- 18) G.M. Pressouyre and I.M. Bernstein : Metall. Trans. A9 ('78) 1571.
- 19) J.J. Au and H.K. Birnbaum : Acta Met. 26 ('78) 1105.
- 20) R.A. Oriani : Acta Met. 18 ('70) 147.
- 21) Y. Sakamoto and J. Eguchi : Proc. Japan Congress on Material Research 19 ('76) 71.
- 22) A.J. Kumnick and H.H. Johnson : Acta Met. 28 ('80) 33.

元素の拡散に関する単行本および解説

- A) A. S. Nowick and J. J. Burton eds. : *Diffusion in Solids* (Academic press 1975).
- B) G. Alefeld and J. Volkl eds : *Hydrogen in Metals I, II* (Springer-Verlag 1978)
- C) 大谷南海男： 金属中の水素の拡散 (日本金属学会編, '金属と水素' p.54 1974)
- D) 藤田英一： 金属中の水素 (日本金属学会会報 18('79) 613)
- E) 深井 務： 金属ハイドライドの物性 (固体物理 16('81) 253)
- F) 萩田繁門： 金属中の水素の低温における挙動 (日本金属学会会報 20('81) 823)